# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-023354

(43)Date of publication of application: 23.01.2002

(51)Int.CI.

G03F 7/004 C08F 20/06 C08F222/06 C08F232/00 C08K 5/00 C08L101/00 C09K 3/00 G03F 7/038 G03F 7/039 H01L 21/027 C07C381/14

(21)Application number: 2000-213021

(22)Date of filing:

13.07.2000

(71)Applicant:

SHIN ETSU CHEM CO LTD

(72)Inventor:

HATAKEYAMA JUN TAKAHASHI TOSHIAKI WATANABE ATSUSHI

**OSAWA YOICHI** 

# (54) RESIST MATERIAL AND PATTERN FORMING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a resist material sensitive to ArF excimer laser light, excellent in sensitivity and resolution, advantageous even to etching because film thickness can be increased and capable of easily forming a fine pattern perpendicular to a substrate.

SOLUTION: In the resist material containing a base resin, an acid generating agent and a solvent, the acid generating agent contains a compound of formula (1) and/or a compound of formula (2). In the formulae, R1 and R2 are the same or different and are each F or a 1–10C fluorinated alkyl; (a) is an integer of 0–5; (b) is an integer of 0–5; and a+b=1–10.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-23354

(P2002-23354A)

(43)公開日 平成14年1月23日(2002.1.23)

(51) Int.Cl.'		識別記号		FI		•	ร์	-7]-ド(参考)
G03F	7/004	503		G 0 3	F 7/004		503A	2H025
		501			•		501	4H006
C08F	20/06			C 0 8	F 20/06			4 J 0 0 2
2	22/06				222/06			4 J 1 0 0
2	22/40				222/40			
			<b>金</b> 本金	<b>半</b> 第令	野党での参り	Ωī	(全 % 百)	単位官に位く

(21)出願番号 特願2000-213021(P2000-213021) (71)出願人 000002060 信起化学工業株式会社 東京都千代田区大手町二丁目6番1号 (72)発明者 島山 潤 新潟県中頚城郡頚城村大字西福島28-1 信起化学工業株式会社合成技術研究所内 (72)発明者 高橋 俊明 新潟県中頚城郡頚城村大字西福島28-1 信起化学工業株式会社合成技術研究所内 (74)代理人 100079304 弁理士 小島 隆司 (外1名)

最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 レジスト材料及びパターン形成方法

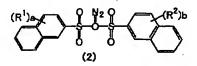
#### (57) 【要約】

【解決手段】 ベース樹脂、酸発生剤及び溶剤を含有してなるレジスト材料において、酸発生剤が下記一般式

(1) 及び/又は(2) で示される化合物を含むことを 特徴とするレジスト材料。

【化1】

$$(R^1)$$
  $(R^2)$   $(R^2)$ 



(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ は同一又は異種のフッ素原子又は炭素数 $1\sim10$ のフッ素化されたアルキル基であり、 $0\leq a\leq 5$ 、 $0\leq b\leq 5$ の整数であり、 $1\leq a+b\leq 10$ の範囲の整数である。)

【効果】 本発明のレジスト材料は、ArFエキシマレーザー光に感応し、感度、解像性に優れ、また厚膜化が

可能なためエッチングにも有利であるために、微細でしかも基板に対して垂直なパターンを容易に形成することができるという特徴を有する。

【請求項1】 ベース樹脂、酸発生剤及び溶剤を含有してなるレジスト材料において、酸発生剤が下記一般式(1)及び/又は(2)で示される化合物を含むことを特徴とするレジスト材料。

【化1】

$$(R^{1})a \longrightarrow (R^{2})b$$

$$(1)$$

$$(R^1)_a$$
  $(R^2)_b$   $(R^2)_b$ 

(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ は同一又は異種のフッ素原子又は炭素数  $1 \sim 10$ のフッ素化されたアルキル基であり、 $0 \le a \le 5$ 、 $0 \le b \le 5$ の整数であり、 $1 \le a + b \le 10$ の範 20 囲の整数である。)

【請求項2】 ベース樹脂が、脂環式構造を含む高分子 構造体であることを特徴とする請求項1記載のレジスト 材料。

2

【請求項3】 ベース樹脂が、ポリアクリル酸及びその 誘導体、ノルボルネン誘導体ー無水マレイン酸交互重合 体とポリアクリル酸又はその誘導体との3もしくは4元 共重合体、テトラシクロドデセン誘導体ー無水マレイン 酸交互重合体とポリアクリル酸又はその誘導体との3も しくは4元共重合体、ノルボルネン誘導体ーマレイミド 交互重合体とポリアクリル酸又はその誘導体との3もし くは4元共重合体、テトラシクロドデセン誘導体ーマレ イミド交互重合体とポリアクリル酸又はその誘導体との 3もしくは4元共重合体、ポリノルボルネン、メタセシ ス開環重合体から選択される1種又は2種以上の高分子 重合体であることを特徴とする請求項1又は2記載のレ ジスト材料。

【請求項4】 ベース樹脂が、下記一般式 (3) で示される繰り返し単位を有する重量平均分子量1,000~500,000の高分子化合物であることを特徴とする請求項1記載のレジスト材料。

(4) 2 | ROOZ ROOI | ROOI | ROOZ ROOI | ROOZ ROOI | ROO

(式中、R<sup>001</sup> は水素原子、メチル基又はCH2 CO2 R 50 <sup>003</sup> を示す。R<sup>002</sup> は水素原子、メチル基又はCO2 R<sup>003</sup>

を示す。R<sup>oc3</sup> は炭素数1~15の直鎖状、分岐状又は 環状のアルキル基を示す。R<sup>004</sup> は水素原子又は炭素数 1~15のカルボキシ基又は水酸基を含有する1価の炭 化水素基を示す。R<sup>005</sup> ~R<sup>008</sup> の少なくとも1個は炭素 数1~15のカルボキシ基又は水酸基を含有する1価の 炭化水素基を示し、残りはそれぞれ独立に水素原子又は 炭素数1~15の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基 を示す。 R<sup>005</sup> ~ R<sup>008</sup> は互いに環を形成していてもよ く、その場合にはR<sup>005</sup> ~ R<sup>008</sup> の少なくとも 1 個は炭素 数1~15のカルボキシ基又は水酸基を含有する2価の 10 炭化水素基を示し、残りはそれぞれ独立に単結合又は炭 素数1~15の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基 を示す。 R<sup>009</sup> は炭素数 3~15の-CO2-部分構造を 含有する1価の炭化水素基を示す。R010~R013の少な くとも1個は炭素数2~15の-CO2-部分構造を含 有する1価の炭化水素基を示し、残りはそれぞれ独立に 水素原子又は炭素数1~15の直鎖状、分岐状又は環状 のアルキル基を示す。 R<sup>010</sup> ~ R<sup>013</sup> は互いに環を形成し ていてもよく、その場合にはROIO ~ ROI3 の少なくとも 1個は炭素数1~15の-CO2-部分構造を含有する 2 価の炭化水素基を示し、残りはそれぞれ独立に単結合 又は炭素数1~15の直鎖状、分岐状又は環状のアルキ レン基を示す。R<sup>014</sup> は炭素数7~15の多環式炭化水 素基又は多環式炭化水素基を含有するアルキル基を示 す。R<sup>015</sup> は酸不安定基を示す。R<sup>016</sup>はメチレン基又は 酸素原子を示す。R<sup>017</sup>は単結合又は炭素数1~10の 直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基であり、ヒドロ キシ基、アルコキシ基、アセチル基、エステル、カーボ ネート、エーテルなどのペテロ原子を含む置換基を含ん でもよい。R<sup>018</sup>は水素原子又は炭素数1~10のアル 30 キル基を示す。kは0又は1である。a1、a2、a 3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1, d 2、d3、e、fはO以上1未満の数であり、a1+a 2+a3+b1+b2+b3+c1+c2+c3+d1 +d2+d3+e+f=1を満足する。)

【請求項5】 請求項2,3又は4記載のベース樹脂、一般式(1)及び/又は(2)で示される酸発生剤、及び溶剤を含有し、請求項2,3又は4記載のベース樹脂が現像液に不溶あるいは難溶であって、酸によって現像液に可溶となるものである化学増幅ポジ型レジスト材料。

【請求項6】 更に塩基性化合物を添加してなることを 特徴とする請求項5記載の化学増幅ポジ型レジスト材 料。

【請求項7】 請求項2,3又は4記載のベース樹脂、一般式(1)及び/又は(2)で示される酸発生剤、及び溶剤と架橋剤を含有し、請求項2,3又は4記載のベース樹脂が現像液に溶解し、酸によって架橋剤が架橋することによって現像液に不溶となるものである化学増幅ネガ型レジスト材料。

【請求項8】 更に塩基性化合物を添加してなることを 特徴とする請求項7記載の化学増幅ネガ型レジスト材 料。

【請求項9】 請求項1万至8のいずれか1項に記載のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、加熱処理後フォトマスクを介して波長200nm以下の光で露光する工程と、必要に応じて加熱処理した後現像液を用いて現像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、(1) 酸発生剤として特定のジアゾニウム化合物を含有し、特に波長200nm以下、特にはArFエキシマレーザー、F2エキシマレーザー、EUVに高感度を示すレジスト材料、及び(2)このレジスト材料を用いたバターン形成方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、LSIの高集積化と高速度化に伴い、パターンルールの微細化が求められているなか、次世代の微細加工技術として遠紫外線リソグラフィーが有望視されている。中でもArFエキシマレーザー光を光源としたフォトリソグラフィーは、0.2 μ m以下の超微細加工に不可欠な技術としてその実現が切望されている。

【0003】ArFエキシマレーザー光を光源としたフ ォトリソグラフィーでは、精密かつ高価な光学系材料の 劣化を防ぐために、少ない露光量で十分な解像性を発揮 できる、感度の高いレジスト材料が求められている。高 感度レジスト材料を実現する方策としては、各組成物と して波長193nmにおいて高透明なものを選択するの が最も一般的である。例えばベース樹脂については、ポ リアクリル酸及びその誘導体、ノルボルネンー無水マレ イン酸交互重合体、ポリノルボルネン及びメタセシス開 環重合体等が提案されており、<br />
樹脂単体の透明性を上げ るという点ではある程度の成果を得ている。一方、酸脱 離置換基として、KェF用の材料においてはアセタール 系の置換基が提案され、オニウム塩あるいはジアゾメタ ン系の酸発生剤と組み合わせることによって高解像化が 可能になった。しかしながら、ArF用のポリマーは、 吸収の問題でフェノール系のポリマーが使えず、カルボ ン酸によって溶解コントラストを得る方法が主流になっ たが、カルボン酸はフェノールに比べて強い酸性を示 し、アセタール置換のカルボン酸は、カルボン酸の酸強 度によって脱離反応が進行し、保存安定性が極端に悪く なった。このため、酸不安定基としては、三級炭素エス テル系が検討され、tープチルエステルやメチルアダマ ンタンエステルが提案されたが、これらの三級炭素エス テル系はアセタールに比べて脱離反応が劣るため、オニ ウム塩を酸発生剤として用いた場合、トリフルオロメタ



(

ンスルホン酸などの超強酸を用いなければ十分な溶解コントラストを得ることができず、添加できる酸発生剤が 限られていた。

【0004】また、レジスト性能としては高解像度化やフォーカス・露光量の十分なマージンを得ることはもちろんであるが、定在波の発生による凹凸の低減や、ラインエッジラフネスの低減も必要な性能である。定在波の発生による凹凸の低減や、ラインエッジラフネスの低減に対しては、オニウム塩系酸発生剤よりもジアゾメタン系酸発生剤の方が優れ、溶解コントラストはアニオンの種類が豊富なオニウム塩が有利とされており、このため複数のオニウム塩やジアゾメタン系の酸発生剤のブレンドによって性能を向上させてきた。なお、ArF用の酸発生剤としてジアゾメタン系の酸発生剤を検討した例がSPIE Vol.3678 p510に報告されている。この場合、ビス(2,4ージメチルフェニルスルホニル)ジアゾメタンを用いているが、十分な解像度を得ることはできなかった。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記事情に鑑 20 みなされたもので、(1)AェFエキシマレーザー光、F2エキシマレーザー光に対して高感度であり、かつ高 透明、高解像でラインエッジラフネスの小さい特性を与える酸発生剤を配合したレジスト材料、(2)該レジスト材料を用いたパターン形成方法を提供することを目的とする。

#### [0006]

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】本 発明者は上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた結果、下記一般式(1)又は(2)で示されるジアゾメタン化合物がArFエキシマレーザー光、F2エキシマレーザー光に対して高感度、高透明であり、このものを配合したレジスト材料が高解像性でラインエッジラフネスの小さい特性を有すること、そしてこのレジスト材料が精密な微細加工に極めて有効であることを知見し、本発明をなすに至った。

【0007】即ち、本発明は下記のレジスト材料を提供する。

[1] ベース樹脂、酸発生剤及び溶剤を含有してなるレジスト材料において、酸発生剤が下記一般式(1)及び/又は(2)で示される化合物を含むことを特徴とするレジスト材料。

### [化3]

$$(R^1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(R^1)_{ab} \longrightarrow (R^2)_{b}$$

$$(2)$$

(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ は同一又は異種のフッ素原子又は炭素数  $1\sim10$ のフッ素化されたアルキル基であり、 $0\leq a\leq 5$ 、 $0\leq b\leq 5$ の整数であり、 $1\leq a+b\leq 10$ の範囲の整数である。)

[2] ベース樹脂が、脂環式構造を含む高分子構造体であることを特徴とする[1] 記載のレジスト材料。

[3] ベース樹脂が、ポリアクリル酸及びその誘導体、ノルボルネン誘導体ー無水マレイン酸交互重合体とポリアクリル酸又はその誘導体との3もしくは4元共重合体、テトラシクロドデセン誘導体ー無水マレイン酸交互重合体とポリアクリル酸又はその誘導体との3もしくは4元共重合体、テトラシクロドデセン誘導体ーマレイミド交互重合体とポリアクリル酸又はその誘導体との3もしくは4元共重合体、テトラシクロドデセン誘導体ーマレイミド交互重合体とポリアクリル酸又はその誘導体との3もしくは4元共重合体、ポリノルボルネン、メタセシス開環重合体から選択される1種又は2種以上の高分子重合体であることを特徴とする[1] 又は[2] 記載のレジスト材料。

[4] ベース樹脂が、下記一般式(3)で示される繰り返し単位を有する重量平均分子量1,000~500,000高分子化合物であることを特徴とする[1]記載のレジスト材料。

#### [化4]

(式中、R<sup>001</sup> は水素原子、メチル基又はCH2 CO2 R 003 を示す。 R<sup>002</sup> は水素原子、メチル基又はCO<sub>2</sub> R<sup>003</sup> を示す。R<sup>003</sup> は炭素数1~15の直鎖状、分岐状又は 環状のアルキル基を示す。R<sup>004</sup> は水素原子又は炭素数 1~15のカルボキシ基又は水酸基を含有する1価の炭 化水素基を示す。R<sup>005</sup> ~ R<sup>008</sup> の少なくとも1個は炭素 数1~15のカルボキシ基又は水酸基を含有する1価の 炭化水素基を示し、残りはそれぞれ独立に水素原子又は **炭素数1~15の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基** を示す。R005 ~ R008 は互いに環を形成していてもよ く、その場合にはRoos ~ Roos の少なくとも1個は炭素 数1~15のカルボキシ基又は水酸基を含有する2価の 炭化水素基を示し、残りはそれぞれ独立に単結合又は炭 素数1~15の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基 を示す。R<sup>009</sup> は炭素数3~15の-CO2-部分構造を 含有する1価の炭化水素基を示す。R010~R013の少な くとも1個は炭素数2~15の-CO2-部分構造を含 有する1価の炭化水素基を示し、残りはそれぞれ独立に 水素原子又は炭素数1~15の直鎖状、分岐状又は環状 のアルキル基を示す。 R<sup>010</sup> ~ R<sup>013</sup> は互いに 象を形成し ていてもよく、その場合にはR010~R013の少なくとも 1個は炭素数1~15の-CO2-部分構造を含有する

2 価の炭化水素基を示し、残りはそれぞれ独立に単結合 又は炭素数1~15の直鎖状、分岐状又は環状のアルキ レン基を示す。R<sup>014</sup> は炭素数7~15の多環式炭化水 素基又は多環式炭化水素基を含有するアルキル基を示 す。R<sup>015</sup> は酸不安定基を示す。R<sup>016</sup>はメチレン基又は 酸素原子を示す。R<sup>017</sup>は単結合又は炭素数1~10の 直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基であり、ヒドロ キシ基、アルコキシ基、アセチル基、エステル、カーボ ネート、エーテルなどのヘテロ原子を含む置換基を含ん でもよい。R<sup>018</sup>は水素原子又は炭素数1~10のアル キル基を示す。kは0又は1である。a1、a2、a 3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1, d 2、d3、e、fは0以上1未満の数であり、a1+a 2+a3+b1+b2+b3+c1+c2+c3+d1 +d2+d3+e+f=1を満足する。) [5] [2], [3] 又は[4] 記載のベース樹脂、一 般式(1)及び/又は(2)で示される酸発生剤、及び 溶剤を含有し、[2], [3] 又は[4] 記載のベース 樹脂が現像液に不溶あるいは難溶であって、酸によって 現像液に可溶となるものである化学増幅ポジ型レジスト

[6] 更に塩基性化合物を添加してなることを特徴とす

材料。



る [5] 記載の化学増幅ポジ型レジスト材料。

[7] [2], [3] 又は [4] 記載のベース樹脂、一般式 (1) 及び/又は (2) で示される酸発生剤、及び溶剤と架橋剤を含有し、 [2], [3] 又は [4] 記載のベース樹脂が現像液に溶解し、酸によって架橋剤が架橋することによって現像液に不溶となるものである化学増幅ネガ型レジスト材料。

[8] 更に塩基性化合物を添加してなることを特徴とする[7] 記載の化学増幅ネガ型レジスト材料。

[9] [1] 乃至[8] のいずれか1項に記載のレジス 10ト材料を基板上に塗布する工程と、加熱処理後フォトマスクを介して波長200nm以下の光で露光する工程と、必要に応じて加熱処理した後現像液を用いて現像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成方法。 [0008] 上記一般式 (1) あるいは (2) で示されるスルホニウム塩は、ArFエキシマレーザー光に対する感度が非常に高く、少ない配合量で十分な量の酸発生が可能である。従って、このものを配合したレジスト材料は高感度かつ高透明性であり、露光一現像で得られるパターンは矩形性が高い上、薄膜化の必要が無いためエッチングに対しても有利である。またラインエッジラフネスや、定在波発生による側壁の凹凸低減にも効果がある。

【0009】上記一般式(1)、(2)で示されるジア ゾメタン化合物は、アリール基がフッ素原子あるいはフ ッ素化されたアルキル基によって置換されており、これ によって発生する酸強度が向上し、三級炭素エステルの 酸脱離基の反応性が向上し、コントラストが向上するこ とによって解像度や、フォーカス・露光マージンが拡大 し、感度も向上する。また、フッ素の導入によって透明 30 性が向上し、髙透明で矩形性の高いレジストパターンを 得ることができる。

【0010】以下、本発明につき更に詳細に説明する。 本発明のレジスト材料は、下記一般式(1)あるいは (2)で示されるジアゾメタン系酸発生剤を含有するも のである。

[0011]

[化5]

$$(R^{1})a \longrightarrow (R^{2})b$$

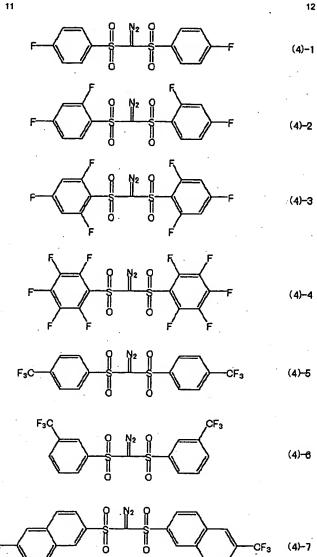
$$(1)$$

$$(R^1)a$$
  $(R^2)b$   $(R^2)b$ 

(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ は同一又は異種のフッ素原子又は炭素数  $1\sim 10$ のフッ素化されたアルキル基であり、具体的にはトリフルオロメチル基、トリフルオロエチル基、ペンタフルオロエチル基、パーフルオローn ーブチル基等が挙げられる。 $0\leq a\leq 5$ 、 $0\leq b\leq 5$ の整数であり、 $1\leq a+b\leq 10$ の範囲の整数である。)

【0012】本発明のレジスト材料に配合する上記一般式(1)及び(2)で示されるジアソメタン系酸発生剤の具体例を以下(4) $-1\sim(4)-7$ に示す。

[0013] [化6]



【0014】一般式(1) あるいは(2) のジアゾメタ ン系酸発生剤の配合量は、ベース樹脂100部(重量 部、以下同様) に対して0.01~15部、特に0.1 ~8部である。配合量が少なすぎると低感度となり、多 すぎると透明性が低下し、レジスト材料の解像性能が低 下することがある。

【0015】本発明において、ベース樹脂としては、脂 環式構造を含む高分子構造体であることが好ましく、特 にポリアクリル酸及びその誘導体、ノルボルネン誘導体 -無水マレイン酸交互重合体とポリアクリル酸又はその 誘導体との3もしくは4元共重合体、テトラシクロドデ セン誘導体ー無水マレイン酸交互重合体とポリアクリル 酸又はその誘導体との3もしくは4元共重合体、ノルボ ルネン誘導体ーマレイミド交互重合体とポリアクリル酸

又はその誘導体との3もしくは4元共重合体、テトラシ クロドデセン誘導体ーマレイミド交互重合体とポリアク リル酸又はその誘導体との3もしくは4元共重合体、ポ リノルボルネン、メタセシス開環重合体から選択される 1種又は2種以上の高分子重合体であることが好まし い。

【0016】特には、ベース樹脂として下記一般式 (3) で示される繰り返し単位を有する重量平均分子量 1,000~500,000、好ましくは5,000~ 100,000の高分子化合物を含有することが好まし い。

[0017] 【化7】

【0018】ここで、R<sup>001</sup> は水素原子、メチル基又は CH2 CO2 R<sup>003</sup> を示す。R<sup>002</sup> は水素原子、メチル基文 はCO2 R<sup>003</sup> を示す。R<sup>003</sup> は炭素数1~15の直鎖 状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、具体的にはメ チル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nー ブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、t ertーアミル基、nーペンチル基、nーヘキシル基、 シクロペンチル基、シクロヘキシル基、エチルシクロペ ンチル基、プチルシクロペンチル基、エチルシクロヘキ シル基、ブチルシクロヘキシル基、アダマンチル基、エ チルアダマンチル基、ブチルアダマンチル基等を例示で きる。R<sup>004</sup> は水素原子又は炭素数1~15のカルボキ シ基又は水酸基を含有する1価の炭化水素基 (好ましく は直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基)を示し、具体 的にはカルボキシエチル、カルボキシブチル、カルボキ シシクロペンチル、カルボキシシクロヘキシル、カルボ キシノルボルニル、カルボキシアダマンチル、ヒドロキ シエチル、ヒドロキシブチル、ヒドロキシシクロペンチ ル、ヒドロキシシクロヘキシル、ヒドロキシノルボルニ ル、ヒドロキシアダマンチル等が例示できる。R<sup>005</sup> ~ R<sup>008</sup> の少なくとも1個は炭素数1~15のカルボキシ 基又は水酸基を含有する1価の炭化水素基(好ましくは

直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基)を示し、残りは それぞれ独立に水素原子又は炭素数1~15の直鎖状、 分岐状又は環状のアルキル基を示す。 炭素数 1~15の カルボキシ基又は水酸基を含有する1価の炭化水素基と しては、具体的にはカルボキシ、カルボキシメチル、カ ルボキシエチル、カルボキシブチル、ヒドロキシメチ ル、ヒドロキシエチル、ヒドロキシブチル、2-カルボ キシエトキシカルボニル、4-カルボキシブトキシカル ボニル、2-ヒドロキシエトキシカルボニル、4-ヒド ロキシブトキシカルボニル、カルボキシシクロペンチル オキシカルボニル、カルボキシシクロヘキシルオキシカ ルボニル、カルボキシノルボルニルオキシカルボニル、 カルボキシアダマンチルオキシカルボニル、ヒドロキシ シクロペンチルオキシカルボニル、ヒドロキシシクロへ キシルオキシカルボニル、ヒドロキシノルボルニルオキ シカルボニル、ヒドロキシアダマンチルオキシカルボニ ル等が例示できる。炭素数1~15の直鎖状、分岐状又 は環状のアルキル基としては、具体的にはR<sup>003</sup> で例示 したものと同様のものが例示できる。R<sup>005</sup> ~R<sup>008</sup> は互 いに環を形成していてもよく、その場合にはROOS ~R 008 の少なくとも1個は炭素数1~15のカルボキシ基 又は水酸基を含有する2価の炭化水素基(好ましくは直



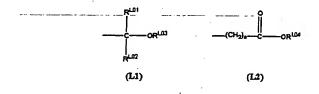
鎖状又は分岐状のアルキレン基)を示し、残りはそれぞ れ独立に単結合又は炭素数1~15の直鎖状、分岐状又 は環状のアルキレン基を示す。 炭素数 1~15のカルボ キシ基又は水酸基を含有する2価の炭化水素基として は、具体的には上記カルボキシ基又は水酸基を含有する 1価の炭化水素基で例示したものから水素原子を1個除 いたもの等を例示できる。 炭素数1~15の直鎖状、分 岐状又は環状のアルキレン基としては、具体的にはR <sup>003</sup> で例示したものから水素原子を1個除いたもの等を 例示できる。R<sup>009</sup> は炭素数3~15の-CO2-部分構 10 造を含有する1価の炭化水素基を示し、具体的には2-オキソオキソランー3ーイル、4,4ージメチルー2ー オキソオキソランー3ーイル、4ーメチルー2ーオキソ オキサンー4ーイル、2ーオキソー1、3ージオキソラ ンー4ーイルメチル、5ーメチルー2ーオキソオキソラ ン-5-イル等を例示できる。R<sup>010</sup> ~ R<sup>013</sup> の少なくと も1個は炭素数2~15の-COz-部分構造を含有す る1価の炭化水素基を示し、残りはそれぞれ独立に水素 原子又は炭素数1~15の直鎖状、分岐状又は環状のア ルキル基を示す。炭素数2~15の-CO2-部分構造 を含有する1価の炭化水素基としては、具体的には2-オキソオキソラン-3-イルオキシカルボニル、4,4 ージメチルー2ーオキソオキソラン-3ーイルオキシカ ルボニル、4-メチルー2-オキソオキサン-4-イル オキシカルボニル、2ーオキソー1、3ージオキソラン -4-イルメチルオキシカルボニル、5-メチル-2-オキソオキソランー5ーイルオキシカルボニル等を例示 できる。炭素数1~15の直鎖状、分岐状又は環状のア ルキル基としては、具体的にはR<sup>003</sup>で例示したものと 同様のものが例示できる。 R<sup>010</sup> ~ R<sup>013</sup> は互いに環を形 成していてもよく、その場合にはROIO ~ROI3 の少なく とも1個は炭素数1~15の-COz-部分構造を含有 する2価の炭化水素基を示し、残りはそれぞれ独立に単 結合又は炭素数1~15の直鎖状、分岐状又は環状のア ルキレン基を示す。炭素数1~15の-COz-部分構

造を含有する2価の炭化水素基としては、具体的には1 ーオキソー2ーオキサプロパン-1, 3ージイル、1. 3-ジオキソー2-オキサプロパン-1, 3-ジイル、 1-オキソー2-オキサブタン-1, 4-ジイル、1. 3-ジオキソー2-オキサプタン-1, 4-ジイル等の 他、上記-CO2-部分構造を含有する1価の炭化水素 基で例示したものから水素原子を1個除いたもの等を例 示できる。炭素数1~15の直鎖状、分岐状又は環状の アルキレン基としては、具体的にはR<sup>003</sup>で例示したも のから水素原子を1個除いたもの等を例示できる。R 014 は炭素数7~15の多環式炭化水素基又は多環式炭 化水素基を含有するアルキル基を示し、具体的にはノル ボルニル、ビシクロ[3.3.1] ノニル、トリシクロ [5. 2. 1. 0<sup>2,6</sup>] デシル、アダマンチル、エチル アダマンチル、ブチルアダマンチル、ノルボルニルメチ ル、アダマンチルメチル等を例示できる。R<sup>015</sup> は酸不 安定基を示す。R<sup>016</sup>はメチレン基又は酸素原子を示 す。R<sup>017</sup>は単結合又は炭素数1~10の直鎖状、分岐 状又は環状のアルキレン基であり、ヒドロキシ基、アル コキシ基、アセチル基、エステル、カーボネート、エー テルなどのヘテロ原子を含む置換基を含んでもよい。R 018は水素原子又は炭素数1~10のアルキル基を示 す。kは0又は1である。a1、a2、a3、b1、b 2, b3, c1, c2, c3, d1, d2, d3, e, f はO以上1未満の数であり、a1+a2+a3+b1 + b 2 + b 3 + c 1 + c 2 + c 3 + d 1 + d 2 + d 3 + e+f=1を満足する。

【0019】R<sup>015</sup> の酸不安定基としては、具体的には下記一般式(L1)~(L5)で示される基、炭素数4~20、好ましくは4~15の非環状の三級アルキル基、各アルキル基がそれぞれ炭素数1~6のトリアルキルシリル基、炭素数4~20のオキソアルキル基等を挙げることができる。

[0020]

[化8]





(LS)

【0021】式中、R<sup>IOI</sup>、R<sup>IOI</sup>は水素原子又は炭素数 1~18、好ましくは1~10の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、具体的にはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nープチル基、secーブチル基、tertーブチル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、2-エチルペキシル基、nーオクチル基等を例示できる。R<sup>IOI</sup>は炭素数1~18、好ましくは1~10の酸素原子等のペテロ原子を有しても

---(CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>--OH ---(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>---O--(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>---CH<sub>2</sub>

よい1 価の炭化水素基を示し、直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、これらの水素原子の一部が水酸基、アルコキシ基、オキソ基、アミノ基、アルキルアミノ基等に 置換されたものを挙げることができ、具体的には下記の 置換アルキル基等が例示できる。

[0022]

【化9】

--(CH2)2-O-(CH2)2-OH

—(СН<sub>2</sub>)в—ОН

【0023】 $R^{LOI}$  と $R^{LOI}$  、 $R^{LOI}$  と $R^{LOI}$  、 $R^{LOI}$  と $R^{LOI}$  とは環を形成してもよく、環を形成する場合には $R^{LOI}$  、 $R^{LOI}$  、 $R^{LOI}$  はそれぞれ炭素数 $1\sim18$ 、好ましくは $1\sim10$ の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す

【0024】RIM は炭素数4~20、好ましくは4~ 15の三級アルキル基、各アルキル基がそれぞれ炭素数 1~6のトリアルキルシリル基、炭素数4~20のオキ ソアルキル基又は上記一般式(L1)で示される基を示 し、三級アルキル基として具体的には、tertーブチ ル基、tertーアミル基、1,1-ジエチルプロピル 基、1-エチルシクロペンチル基、1-ブチルシクロペ ンチル基、1-エチルシクロヘキシル基、1-ブチルシ クロヘキシル基、1-エチル-2-シクロペンテニル 基、1-エチルー2-シクロヘキセニル基、2-メチル 30 -2-アダマンチル基等が挙げられ、トリアルキルシリ ル基として具体的には、トリメチルシリル基、トリエチ ルシリル基、ジメチルーtertープチルシリル基等が 挙げられ、オキソアルキル基として具体的には、3-オ キソシクロヘキシル基、4-メチル-2-オキソオキサ ン-4-イル基、5-メチル-5-オキソオキソラン-4-イル基等が挙げられる。aは0~6の整数である。 【0·0 2·5】 R<sup>LOS</sup> は炭素数 1~8の直鎖状、分岐状又 は環状のアルキル基又は炭素数6~20の置換されてい てもよいアリール基を示し、直鎖状、分岐状又は環状の 40 アルキル基として具体的には、メチル基、エチル基、プ ロピル基、イソプロピル基、nープチル基、secーブ チル基、tertープチル基、tertーアミル基、n -ペンチル基、n-ヘキシル基、シクロペンチル基、シ クロヘキシル基、シクロペンチルメチル基、シクロペン チルエチル基、シクロヘキシルメチル基、シクロヘキシ ルエチル基等を例示でき、置換されていてもよいアリー ル基として具体的にはフェニル基、メチルフェニル基、 ナフチル基、アンスリル基、フェナンスリル基、ピレニ ル基等を例示できる。mは0又は1、nは0、1、2、

3のいずれかであり、2m+n=2又は3を満足する数である。

【0026】R<sup>106</sup> は炭素数1~8の直鎖状、分岐状又 は環状のアルキル基又は炭素数6~20の置換されてい てもよいアリール基を示し、具体的にはRios と同様の ものが例示できる。RLOT ~RLIG はそれぞれ独立に水素 原子又は炭素数1~15のヘテロ原子を含んでもよい1 価の炭化水素基を示し、メチル基、エチル基、プロピル 基、イソプロピル基、nープチル基、secープチル 基、tertーブチル基、tertーアミル基、nーペ ンチル基、nーヘキシル基、nーオクチル基、nーノニ ル基、nーデシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシ ル基、シクロペンチルメチル基、シクロペンチルエチル 基、シクロペンチルブチル基、シクロヘキシルメチル 基、シクロヘキシルエチル基、シクロヘキシルブチル基 等の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、これらの水 素原子の一部が水酸基、アルコキシ基、カルボキシ基、 アルコキシカルボニル基、オキソ基、アミノ基、アルキ ルアミノ基、シアノ基、メルカプト基、アルキルチオ 基、スルホ基等に置換されたものを例示できる。 R<sup>LOT</sup> ~RLI6 は互いに環を形成していてもよく(例えば、R LO7 & RLO8 \ RLO7 & RLO9 \ RLO8 & RLO0 \ RLO9 & R LIO 、RLII とRLIZ 、RLI3 とRLI4 等)、その場合には 炭素数1~15のヘテロ原子を含んでもよい2価の炭化 水素基を示し、上記1価の炭化水素基で例示したものか ら水素原子を1個除いたもの等を例示できる。また、R LOT ~RLI6 は隣接する炭素に結合するもの同士で何も介 さずに結合し、二重結合を形成してもよい(例えば、R LO7 とRLO9 、RLO9 とRLI5 、RLI3 とRLI5 等)。

【0027】上記式(L1)で示される酸不安定基のうち直鎖状又は分岐状のものとしては、具体的には下記の 基が例示できる。

[0028]

【化10】

【0029】上記式(L1)で示される酸不安定基のうち環状のものとしては、具体的にはテトラヒドロフラン 30 -2-イル基、2-メチルテトラヒドロフラン-2-イル基、アトラヒドロピラン-2-イル基等が例示できる。

【0030】上記式(L2)の酸不安定基としては、具体的にはtertープトキシカルボニル基、tertープトキシカルボニル基、tertープトキシカルボニルメチル基、tertーアミロキシカルボニル基、tertーアミロキシカルボニル基、tertーアミロキシカルボニル基、1、1ージエチルプロピルオキシカルボニルメチル基、1、1ージエチルプロピルオキシカルボニルメチル基、1ーエチルシクロペンチルオキシカルボニルメチル基、1ーエチルー2ーシクロペンテニルオキシカルボニルメチル基、1ーエナルー2ーシクロペンテニルオキシカルボニルメチル基、2ーテトラヒドロピラニルオキシカルボニルメチル基、2ーテトラヒドロピラニルオキシカルボニルメチル基、2ーテトラヒドロピラニルオキシカルボニルメチル基、2ーテ

トラヒドロフラニルオキシカルボニルメチル基等が例示できる。

【0031】上記式(L3)の酸不安定基としては、具体的には1ーメチルシクロペンチル、1ーエチルシクロペンチル、1ーロープロピルシクロペンチル、1ーイソプロピルシクロペンチル、1ーsecープチルシクロペンチル、1ーメチルシクロペンチル、1ーエチルシクロペンチル、3ーメチルー1ーシクロペンテンー3ーイル、3ーメチルー1ーシクロペンテンー3ーイル、3ーメチルー1ーシクロペンテンー3ーイル、3ーメチルー1ーシクロペンテンー3ーイル、3ーメチルー1ーシクロへキセンー3ーイル等が例示できる。

【0032】上記式(L4)の酸不安定基としては、具体的には下記の基が例示できる。

[0033]

【化11】

【0034】上記式(L5)の酸不安定基としては、具 体的には下記の基が例示できる。

【化12】





【0035】また、R<sup>015</sup> の酸不安定基の三級アルキル 基、トリアルキルシリル基、オキソアルキル基として は、先に例示したものを挙げることができる。

【0036】なお、本発明のレジスト材料に配合する高分子化合物の重量平均分子量は1,000~500,000、好ましくは3,000~100,000である。この範囲を外れると、エッチング耐性が極端に低下したり、露光前後の溶解速度差が確保できなくなって解像性が低下したりすることがある。

【0037】また、上記高分子化合物は1種に限らず2種以上を添加することができる。複数種の高分子化合物を用いることにより、レジスト材料の性能を調整することができる。

【0038】なお、本発明のレジスト材料は、上記ベース樹脂の種類によって、即ち、ベース樹脂が現像液に不溶又は難溶であって、酸によって現像液に可溶となるものはポジ型として使用し得、一方、ベース樹脂が現像液に溶解し、酸によって架橋剤が架橋することによって現像液に不溶となるものはネガ型として使用し得るが、前者のベース樹脂としては、カルボン酸の水酸基の水素原子が、(L1)~(L5)で示される酸不安定基で置換されているポリマーが挙げられ、後者のベース樹脂としては、架橋点となるカルボン酸あるいはアルコールを含むポリマーが挙げられる。

【0039】本発明のレジスト材料には、式(1)、

(2) の酸発生剤以外の酸発生剤を併用して配合することができる。

【0040】例えば、

i. 下記一般式 (Pla-1)、 (Pla-2) 又は

(P1b) のオニウム塩、

i i. 下記一般式 (P2) のジアゾメタン誘導体、

i i i . 下記一般式(P3)のグリオキシム誘導体、

i v. 下記一般式(P 4)のピススルホン誘導体、

v. 下記一般式 (P5) のN-ヒドロキシイミド化合物 のスルホン酸エステル、

v i. β-ケトスルホン酸誘導体、

v i i. ジスルホン誘導体、

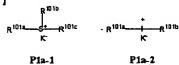
v i i i . ニトロベンジルスルホネート誘導体、

ix.スルホン酸エステル誘導体

等が挙げられる。

[0041]

(化13)



(式中、R<sup>101a</sup>、R<sup>101b</sup>、R<sup>101c</sup> はそれぞれ炭素数1~12の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、アルケニル基、オキソアルキル基又はオキソアルケニル基、炭素数6~20のアリール基、又は炭素数7~12のアラルキル基又はアリールオキソアルキル基を示し、これらの基の水素原子の一部又は全部がアルコキシ基等によって置換されていてもよい。また、R<sup>101b</sup> とR<sup>101c</sup> とは環を形成してもよく、環を形成する場合には、R<sup>101b</sup>、R<sup>101c</sup> はそれぞれ炭素数1~6のアルキレン基を示す。K<sup>101c</sup> はそれぞれ炭素数1~6のアルキレン基を示す。K<sup>101c</sup> はま求核性対向イオンを表す。)

【0042】上記R<sup>101a</sup>、R<sup>101b</sup>、R<sup>101c</sup> は互いに同一であっても異なっていてもよく、具体的にはアルキル基として、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nープチル基、secープチル基、tertープ40 チル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロペナル基、シクロペキシル基、シクロペキシル基、シクロペキシル基、シクロペキシルメチル基、ノルボルニル基、アダマンチル基等が挙げられる。アルケニル基としては、ビニル基、アリル基、プロペニル基、ブテニル基、ヘキセニル基、シクロヘキセニル基等が挙げられる。オキソアルキル基としては、2ーオキソシクロペンチルースーオキソプロピル基、2ーシクロペンチルー2ーオキソエチル基、エチル基、2ーシクロヘキシルー2ーオキソエチル基、

22

2-(4-メチルシクロヘキシル)-2-オキソエチル 基等を挙げることができる。アリール基としては、フェ ニル基、ナフチル基等や、pーメトキシフェニル基、m ーメトキシフェニル基、oーメトキシフェニル基、エト キシフェニル基、p-tert-ブトキシフェニル基、 mーtertープトキシフェニル基等のアルコキシフェ ニル基、2ーメチルフェニル基、3ーメチルフェニル 基、4-メチルフェニル基、エチルフェニル基、4-t ertープチルフェニル基、4ープチルフェニル基、ジ メチルフェニル基等のアルキルフェニル基、メチルナフ 10 チル基、エチルナフチル基等のアルキルナフチル基、メ トキシナフチル基、エトキシナフチル基等のアルコキシ ナフチル基、ジメチルナフチル基、ジエチルナフチル基 等のジアルキルナフチル基、ジメトキシナフチル基、ジ エトキシナフチル基等のジアルコキシナフチル基等が挙 げられる。アラルキル基としてはベンジル基、フェニル エチル基、フェネチル基等が挙げられる。アリールオキ ソアルキル基としては、2-フェニル-2-オキソエチ ル基、2-(1-ナフチル)-2-オキソエチル基、2 - (2-ナフチル) - 2-オキソエチル基等の2-アリ ールー2-オキソエチル基等が挙げられる。K-の非求 核性対向イオンとしては塩化物イオン、臭化物イオン等 のハライドイオン、トリフレート、1,1,1ートリフ ルオロエタンスルホネート、ノナフルオロブタンスルホ ネート等のフルオロアルキルスルホネート、トシレー ト、ベンゼンスルホネート、4-フルオロベンゼンスル ホネート、1, 2, 3, 4, 5-ペンタフルオロベンゼ ンスルホネート等のアリールスルホネート、メシレー ト、ブタンスルホネート等のアルキルスルホネートが挙 げられる。

[0043] [化14]

P1b

(式中、 $R^{102a}$  、 $R^{102b}$  はそれぞれ炭素数  $1\sim8$  の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。 $R^{103}$  は炭素数  $1\sim1$  のの直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を 40 示す。 $R^{104a}$  、 $R^{104b}$  はそれぞれ炭素数  $3\sim7$  の 2- オキソアルキル基を示す。 $K^-$  は非求核性対向イオンを表す。)

【0044】上記R<sup>ICLa</sup>、R<sup>ICLb</sup> として具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロペキシルメチル基、4-メチルシクロヘキシル基、シクロヘキシルメチル基等が挙げられる。R<sup>ICLa</sup>としては、メチレン基、

エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン 基、ヘキシレン基、ヘプチレン基、オクチレン基、ノニレン基、1,4ーシクロヘキシレン基、1,4ーシクロオクチレン基、1,4ーシクロオクチレン基、1,4ーシクロオクチレン基、1,4ーシクロペンチレン基等が挙げられる。R<sup>104a</sup>、R<sup>104b</sup>としては、2ーオキソプロピル基、2ーオキソシクロペンチル基、2ーオキソシクロヘブチル基等が挙げられる。K・は式(P1aー1)及び(P1aー2)で説明したものと同様のものを挙げることができる。

[0045] 【化15】

(式中、R<sup>105</sup>、R<sup>106</sup>は炭素数1~12の直鎖状、分岐 状又は環状のアルキル基又はハロゲン化アルキル基、炭 素数6~20のアリール基又はハロゲン化アリール基、 又は炭素数7~12のアラルキル基を示す。)

【0046】R<sup>105</sup>、R<sup>106</sup>のアルキル基としてはメチル 基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチ ル基、secーブチル基、tertーブチル基、ペンチ ル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、アミル 基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘブ チル基、ノルボルニル基、アダマンチル基等が挙げられ る。ハロゲン化アルキル基としてはトリフルオロメチル 基、1,1,1-トリフルオロエチル基、1,1,1-30 トリクロロエチル基、ノナフルオロブチル基等が挙げら れる。アリール基としてはフェニル基、pーメトキシフ エニル基、mーメトキシフェニル基、oーメトキシフェ ニル基、エトキシフェニル基、p-tert-ブトキシ フェニル基、m-tert-プトキシフェニル基等のア ルコキシフェニル基、2ーメチルフェニル基、3ーメチ ルフェニル基、4-メチルフェニル基、エチルフェニル 基、4-tertープチルフェニル基、4-プチルフェ ニル基、ジメチルフェニル基等のアルキルフェニル基が 挙げられる。アラルキル基としてはベンジル基、フェネ チル基等が挙げられる。

[0047]

(式中、 $R^{107}$ 、 $R^{108}$ 、 $R^{109}$  は炭素数  $1 \sim 1$  2 の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基又はハロゲン化アルキル基、炭素数  $6 \sim 2$  0 のアリール基又はハロゲン化アリール基、又は炭素数  $7 \sim 1$  2 のアラルキル基を示す。 R

IOS 、RIOS は互いに結合して環状構造を形成してもよく、環状構造を形成する場合、RIOS 、RIOS はそれぞれ 炭素数1~6の直鎖状、分岐状のアルキレン基を示す。)

【0048】 R<sup>107</sup>、 R<sup>108</sup>、 R<sup>109</sup> のアルキル基、ハロゲン化アルキル基、アリール基、ハロゲン化アリール基、アラルキル基としては、R<sup>106</sup>、 R<sup>106</sup> で説明したものと同様の基が挙げられる。なお、R<sup>108</sup>、 R<sup>109</sup> のアルキレン基としてはメチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ヘキシレン基等が挙げられる。

[0049]

【化17】

(式中、R<sup>101a</sup> 、R<sup>101b</sup> は上記と同じである。) 【0050】

【化18】

(式中、R<sup>110</sup> は炭素数6~10のアリーレン基、炭素数1~6のアルキレン基又は炭素数2~6のアルケニレン基を示し、これらの基の水素原子の一部又は全部は更に炭素数1~4の直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルコキシ基、ニトロ基、アセチル基、又はフェニル基で置換されていてもよい。R<sup>111</sup> は炭素数1~8の直鎖状、分岐状又は置換のアルキル基、アルケニル基又はアルコキシアルキル基、フェニル基、又はナフチル基を示し、これらの基の水素原子の一部又は全部は更に炭素数1~4のアルキル基又はアルコキシ基;炭素数1~4のアルキル基又はアルコキシ基;炭素数1~4のアルキル基、アルコキシ基、ニトロ基又はアセチル基で置換されていてもよいフェニル基;炭素数3~5のヘテロ芳香族基;又は塩素原子、フッ素原子で置換されていてもよい。)

【0051】ここで、R<sup>110</sup>のアリーレン基としては、
1,2ーフェニレン基、1,8ーナフチレン基等が、ア 40
ルキレン基としては、メチレン基、1,2ーエチレン
基、1,3ープロピレン基、1,4ープチレン基、1ーフェニルー1,2ーエチレン基、ノルボルナンー2,3ージイル基等が、アルケニレン基としては、1,2ーピニレン基、1ーフェニルー1,2ーピニレン基、5ーノルボルネンー2,3ージイル基等が挙げられる。R<sup>111</sup>のアルキル基としては、R<sup>101a</sup>~R<sup>101c</sup>と同様のものが、アルケニル基としては、ビニル基、1ープロペニル基、アリル基、1ープテニル基、3ープテニル基、イソプレニル基、1ーペンテニル基、3ーペンテニル基、450

ーペンテニル基、ジメチルアリル基、1ーへキセニル 基、3ーへキセニル基、5ーへキセニル基、1ーヘプテ ニル基、3ーヘプテニル基、6ーヘプテニル基、7ーオ クテニル基等が、アルコキシアルキル基としては、メト キシメチル基、エトキシメチル基、プロポキシメチル 基、ブトキシメチル基、ペンチロキシメチル基、ヘキシ ロキシメチル基、ヘプチロキシメチル基、メトキシエチ ル基、エトキシエチル基、プロポキシエチル基、ブトキ シエチル基、ペンチロキシエチル基、ブトキ シエチル基、ペンチロキシエチル基、メトキシプロピル基、ブロ ポキシプロピル基、ブトキシプロピル基、メトキシブチ ル基、エトキシブチル基、プロポキシブチル基、メトキ シペンチル基、エトキシペンチル基、メトキシへキシル

【0052】なお、更に置換されていてもよい炭素数1~4のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロビル基、イソブロビル基、ローブチル基、イソブチル基、tertーブチル基等が、炭素数1~4のアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ローブトキシ基、イソブトキシ基、tertーブトキシ基等が、炭素数1~4のアルキル基、アルコキシ基、ニトロ基又はアセチル基で置換されていてもよいフェニル基としては、フェニル基、トリル基、pーtertーブトキシフェニル基、pーアセチルフェニル基、pーニトロフェニル基等が、炭素数3~5のヘテロ芳香族基としては、ピリジル基、フリル基等が挙げられる。

基、メトキシヘプチル基等が挙げられる。

【0053】具体的には、例えばトリフルオロメタンス ルホン酸ジフェニルヨードニウム、トリフルオロメタン スルホン酸 (pーtertープトキシフェニル) フェニ ·ルョードニウム、pートルエンスルホン酸ジフェニルヨ ードニウム、pートルエンスルホン酸(pーtertー プトキシフェニル)フェニルヨードニウム、トリフルオ ロメタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフ ルオロメタンスルホン酸(pーtertープトキシフェ ニル) ジフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンス ルホン酸ビス(pーtertーブトキシフェニル)フェ ニルスルボニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリ ス (pーtertープトキシフェニル) スルホニウム、 pートルエンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、p ートルエンスルホン酸(pーtert-プトキシフェニ ル) ジフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸 ピス (p-tert-プトキシフェニル) フェニルスル ホニウム、pートルエンスルホン酸トリス(pーteェ t-プトキシフェニル) スルホニウム、ノナフルオロブ タンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、ブタンスル ホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフルオロメタン スルホン酸トリメチルスルホニウム、pートルエンスル ホン酸トリメチルスルホニウム、トリフルオロメタンス ルホン酸シクロヘキシルメチル (2-オキソシクロヘキ



シル) スルホニウム、p-トルエンスルホン酸シクロへ キシルメチル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウ ム、トリフルオロメタンスルホン酸ジメチルフェニルス ルホニウム、pートルエンスルホン酸ジメチルフェニル スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸ジシクロ ヘキシルフェニルスルホニウム、pートルエンスルホン 酸ジシクロヘキシルフェニルスルホニウム、トリフルオ ロメタンスルホン酸トリナフチルスルホニウム、トリフ ルオロメタンスルホン酸シクロヘキシルメチル (2-オ キソシクロヘキシル) スルホニウム、トリフルオロメタ ンスルホン酸 (2-ノルボニル) メチル (2-オキソシ クロヘキシル) スルホニウム、エチレンビス [メチル (2-オキソシクロペンチル) スルホニウムトリフルオ ロメタンスルホナート]、1,2'-ナフチルカルボニ ルメチルテトラヒドロチオフェニウムトリフレート等の オニウム塩、ビス (ベンゼンスルホニル) ジアソメタ ン、ビス (p-トルエンスルホニル) ジアゾメタン、ビ ス (キシレンスルホニル) ジアゾメタン、ピス (シクロ ヘキシルスルホニル) ジアソメタン、ピス (シクロペン チルスルホニル) ジアゾメタン、ピス (nーブチルスル 20 ホニル) ジアゾメタン、ピス (イソプチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (sec-ブチルスルホニル) ジア ゾメタン、ピス (n-プロピルスルホニル) ジアゾメタ ン、ビス(イソプロピルスルホニル)ジアゾメタン、ビ ス(tertープチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス (n-アミルスルホニル) ジアゾメタン、ピス (イソア ミルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (sec-アミル スルホニル) ジアゾメタン、ビス(tertーアミルス ルホニル) ジアソメタン、1-シクロヘキシルスルホニ ルー1- (tert-ブチルスルホニル) ジアゾメタ ン、1ーシクロヘキシルスルホニルー1ー(tertー アミルスルホニル) ジアゾメタン、1-tert-アミ ルスルホニルー1ー(tertープチルスルホニル)ジ アゾメタン等のジアゾメタン誘導体、ピスーOー(p-トルエンスルホニル) -α-ジメチルグリオキシム、ビ ス-O- (p-トルエンスルホニル) -α-ジフェニル グリオキシム、ピス-O-(p-トルエンスルホニル) - α - ジンクロヘキシルグリオキシム、-ピス-O--(p -トルエンスルホニル)-2,3-ペンタンジオングリ オキシム、ピス-O- (p-トルエンスルホニル) -2 40 ーメチルー3、4ーペンタンジオングリオキシム、ビス -O- (n-プタンスルホニル) -α-ジメチルグリオ キシム、ビス-Ο- (n-プタンスルホニル) -α-ジ フェニルグリオキシム、ピスー〇一(nープタンスルホ ニル) -α-ジシクロヘキシルグリオキシム、ビス-Ο - (n-ブタンスルホニル) -2, 3-ペンタンジオン グリオキシム、ビス-O- (n-ブタンスルホニル) -2-メチル-3, 4-ペンタンジオングリオキシム、ビ ス-Ο- (メタンスルホニル) -α-ジメチルグリオキ

αージメチルグリオキシム、ピスー〇ー(1, 1, 1-トリフルオロエタンスルホニル) -α-ジメチルグリオ キシム、ピスー〇ー(tertーブタンスルホニル)~ αージメチルグリオキシム、ビス-O- (パーフルオロ オクタンスルホニル)ーαージメチルグリオキシム、ピ ス-Ο-(シクロヘキサンスルホニル) -α-ジメチル グリオキシム、ピス-O-(ベンゼンスルホニル) -a ージメチルグリオキシム、ビスーO- (p-フルオロベ ンゼンスルホニル) -α-ジメチルグリオキシム、ビス -O-(p-tert-プチルベンゼンスルホニル)α-ジメチルグリオキシム、ビス-O- (キシレンスル ホニル) ーαージメチルグリオキシム、ビスー〇ー (カ ンファースルホニル) ーαージメチルグリオキシム等の グリオキシム誘導体、ピスナフチルスルホニルメタン、 ビストリフルオロメチルスルホニルメタン、ビスメチル・ スルホニルメタン、ピスエチルスルホニルメタン、ピス プロピルスルホニルメタン、ビスイソプロピルスルホニ ルメタン、ピスーpートルエンスルホニルメタン、ピス ベンゼンスルホニルメタン等のピススルホン誘導体、2 ーシクロヘキシルカルボニルー2- (p-トルエンスル ホニル) プロパン、2ーイソプロピルカルボニルー2ー (p-トルエンスルホニル) プロパン等の β-ケトスル ホン誘導体、ジフェニルジスルホン、ジシクロヘキシル ジスルホン等のジスルホン誘導体、p-トルエンスルホ・ ン酸2, 6-ジニトロベンジル、p-トルエンスルホン 酸2, 4-ジニトロベンジル等のニトロベンジルスルホ ネート誘導体、1,2,3ートリス (メタンスルホニル オキシ) ベンゼン、1, 2, 3-トリス (トリフルオロ メタンスルホニルオキシ) ベンゼン、1, 2, 3ートリ ス (p-トルエンスルホニルオキシ) ベンゼン等のスル ホン酸エステル誘導体、N-ヒドロキシスクシンイミド メタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイ ミドトリフルオロメタンスルホン酸エステル、Nーヒド ロキシスクシンイミドエタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミド1ープロパンスルホン酸エス テル、N-ヒドロキシスクシンイミド2-プロパンスル ホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミド1-ペ ンタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイ ミド1ーオクタンスルホン酸エステル、Nーヒドロキシ スクシンイミドpートルエンスルホン酸エステル、Nー ヒドロキシスクシンイミドpーメトキシベンゼンスルホ ン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミド2-クロ ロエタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシン イミドベンゼンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシス クシンイミドー2, 4, 6-トリメチルベンゼンスルホ ン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミド1-ナフ タレンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイ ミド2ーナフタレンスルホン酸エステル、N-ヒドロキ シー2ーフェニルスクシンイミドメタンスルホン酸エス シム、ビス-O-(トリフルオロメタンスルホニル)- 50 テル、N-ヒドロキシマレイミドメタンスルホン酸エス



テル、N-ヒドロキシマレイミドエタンスルホン酸エス テル、N-ヒドロキシー2-フェニルマレイミドメタン スルホン酸エステル、Nーヒドロキシグルタルイミドメ タンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシグルタルイミ ドベンゼンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシフタル イミドメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシフタ ルイミドベンゼンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシ フタルイミドトリフルオロメタンスルホン酸エステル、 Nーヒドロキシフタルイミドゥートルエンスルホン酸エ ステル、Nーヒドロキシナフタルイミドメタンスルホン 酸エステル、N-ヒドロキシナフタルイミドベンゼンス ルホン酸エステル、N-ヒドロキシ-5-ノルボルネン -2, 3-ジカルボキシイミドメタンスルホン酸エステ ル、N-ヒドロキシー5-ノルボルネン-2、3-ジカ ルボキシイミドトリフルオロメタンスルホン酸エステ ル、N-ヒドロキシー5-ノルボルネン-2, 3-ジカ ルボキシイミドpートルエンスルホン酸エステル等のN ーヒドロキシイミド化合物のスルホン酸エステル誘導体 等が挙げられるが、トリフルオロメタンスルホン酸トリ フェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸 20 (p-tert-ブトキシフェニル) ジフェニルスルホ ニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリス (p-t ertープトキシフェニル) スルホニウム、pートルエ ンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、pートルエン スルホン酸 (p-tert-プトキシフェニル) ジフェ ニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリス (p ーtertープトキシフェニル)スルホニウム、トリフ ルオロメタンスルホン酸トリナフチルスルホニウム、ト・ リフルオロメタンスルホン酸シクロヘキシルメチル (2 ーオキソシクロヘキシル) スルホニウム、トリフルオロ 30 メタンスルホン酸 (2-ノルボニル) メチル (2-オキ ソシクロヘキシル) スルホニウム、1,2'ーナフチル カルボニルメチルテトラヒドロチオフェニウムトリフレ ート等のオニウム塩、ピス (ベンゼンスルホニル) ジア ゾメタン、ピス (p-トルエンスルホニル) ジアゾメタ ン、ピス(シクロヘキシルスルホニル)ジアゾメタン、 ピス (nープチルスルホニル) ジアソメタン、ピス (イ ソプチルスルホニル) ジアゾメタン、ピス (secーブ チルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (n-プロビルス ルホニル) ジアゾメタン、ビス (イソプロピルスルホニ 40 ル) ジアゾメタン、ピス (tertープチルスルホニ ル)ジアゾメタン等のジアゾメタン誘導体、ピスー〇一 (p-トルエンスルホニル) -α-ジメチルグリオキシ ム、ピスーOー(nープタンスルホニル)ーαージメチ ルグリオキシム等のグリオキシム誘導体、ピスナフチル スルホニルメタン等のピススルホン誘導体、Nーヒドロ キシスクシンイミドメタンスルホン酸エステル、N-ヒ ドロキシスクシンイミドトリフルオロメタンスルホン酸 エステル、N-ヒドロキシスクシンイミド1-プロパン スルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミド2 50

ープロパンスルホン酸エステル、Nーヒドロキシスクシンイミド1ーペンタンスルホン酸エステル、Nーヒドロキシスクシンイミドpートルエンスルホン酸エステル、Nーヒドロキシナフタルイミドメタンスルホン酸エステル、Nーヒドロキシナフタルイミドベンゼンスルホン酸エステル等のNーヒドロキシイミド化合物のスルホン酸エステル等導体が好ましく用いられる。なお、上記酸発生剤は1種を単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができる。オニウム塩は矩形性向上効果に優れ、ジアゾメタン誘導体及びグリオキシム誘導体は定在波低減効果に優れるため、両者を組み合わせることによりプロファイルの微調整を行うことが可能である。

【0054】上記酸発生剤の添加量は、上記式(1)のスルホニウム塩との合計量として、ベース樹脂100部に対して好ましくは0.1~15部、より好ましくは0.5~8部である。0.1部より少ないと低感度となり、15部より多いと透明性が低下し、レジスト材料の解像性能が低下することがある。

【0055】本発明で使用される有機溶剤としては、ベ ース樹脂、酸発生剤、その他の添加剤等が溶解可能な有 機溶剤であればいずれでもよい。このような有機溶剤と しては、例えばシクロヘキサノン、メチルー2-n-ア ミルケトン等のケトン類、3ーメトキシブタノール、3 ーメチルー3ーメトキシブタノール、1ーメトキシー2 ープロパノール、1-エトキシー2-プロパノール等の アルコール類、プロピレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレ ングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコール モノエチルエーテル、プロピレングリコールジメチルエ ーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル等のエ ーテル類、プロピレングリコールモノメチルエーテルア セテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルア セテート、乳酸エチル、ピルビン酸エチル、酢酸ブチ ル、3-メトキシプロピオン酸メチル、3-エトキシブ ロピオン酸エチル、酢酸teェt-ブチル、プロピオン 酸tertープチル、プロピレングリコールモノter tープチルエーテルアセテート等のエステル類が挙げら れ、これらの1種を単独で又は2種以上を混合して使用 することができるが、これらに限定されるものではな い。本発明では、これらの有機溶剤の中でもレジスト成 分中の酸発生剤の溶解性が最も優れているジエチレング リコールジメチルエーテルや1-エトキシー2-プロパ ノールの他、安全溶剤であるプロピレングリコールモノ メチルエーテルアセテート及びその混合溶剤が好ましく 使用される。

【0056】有機溶剤の使用量は、ベース樹脂100部に対して200~1,000部、特に400~800部が好適である。

【0057】本発明のレジスト材料には、更に溶解制御剤を添加することができる。溶解制御剤としては、平均



分子量が100~1,000、好ましくは150~800で、かつ分子内にフェノール性水酸基を2つ以上有する化合物の該フェノール性水酸基の水素原子を酸不安定基により全体として平均0~100モル%の割合で又は分子内にカルボキシ基を有する化合物の該カルボキシ基の水素原子を酸不安定基により全体として平均80~100モル%の割合で置換した化合物を配合する。

【0058】なお、フェノール性水酸基又はカルボキシ 基の水素原子の酸不安定基による置換率は、平均でフェ ノール性水酸基又はカルボキシ基全体の0モル%以上、 好ましくは30モル%以上であり、その上限は100モル%、より好ましくは80モル%である。

【0059】この場合、かかるフェノール性水酸基を2つ以上有する化合物又はカルボキシ基を有する化合物としては、下記式(D1)~(D14)で示されるものが好ましい。

[0060] [化19]

. .

D1

R<sup>201</sup>

(OH), R<sup>201</sup>, R<sup>201</sup>

D4

(OH), (OH),

R<sup>201</sup>, (OH)<sub>r</sub>.

(OH), (OH),

СНЭ, СООН D13

(但し、式中 $R^{201}$ 、 $R^{202}$  はそれぞれ水素原子、又は炭素数  $1\sim8$  の直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルケニル基を示す。 $R^{203}$  は水素原子、又は炭素数  $1\sim8$  の直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルケニル基、あるいは $-(R^{207})$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_$ 

(CH<sub>3</sub>2CH CH<sub>3</sub>2CH CH<sub>3</sub>CH)

D2

(OH), R<sup>201</sup>, R<sup>202</sup>, OH),

(Ori)<sub>r</sub> (Or

R<sup>201</sup>s (OH)<sub>t</sub>

(OH)<sub>1</sub>, (OH)<sub>2</sub>, (OH)<sub>2</sub>, (OH)<sub>3</sub>, (OH

D12 COOCH

R<sup>208</sup> COOH R<sup>208</sup> CH<sub>0</sub> COOH R<sup>208</sup> D14

基、カルボニル基、スルホニル基、酸素原子又は硫黄原子を示す。R<sup>205</sup> は炭素数1~10のアルキレン基、炭素数6~10のアリーレン基、カルボニル基、スルホニル基、酸素原子又は硫黄原子を示す。R<sup>206</sup> は水素原子、炭素数1~8の直鎖状又は分岐状のアルキル基、アルケニル基、又はそれぞれ水酸基で置換されたフェニル

基又はナフチル基を示す。 $R^{207}$  は炭素数  $1\sim10$ の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。 $R^{208}$  は水素原子又は水酸基を示す。j は $0\sim5$  の整数である。u、h は0 又は1 である。s、t、s′、t′、s′、t′、t′ はそれぞれs+t=8、s′ +t′ =5、s′ +t′ =4 を満足し、かつ各フェニル骨格中に少なくとも 1 つの水酸基を有するような数である。a は式(D 8)、(D 9)の化合物の分子量を 1 0 0 0 とする数である。)

【0061】上記式中R<sup>201</sup>、R<sup>202</sup> としては、例えば水 10 素原子、メチル基、エチル基、ブチル基、プロピル基、 エチニル基、シクロヘキシル基、R<sup>203</sup> としては、例え ばR<sup>201</sup>、R<sup>202</sup> と同様なもの、あるいは一COOH、一 CH<sub>2</sub> COOH、R<sup>204</sup> としては、例えばエチレン基、フ エニレン基、カルボニル基、スルホニル基、酸素原子、硫黄原子等、R<sup>205</sup> としては、例えばメチレン基、あるいはR<sup>204</sup> と同様なもの、R<sup>206</sup> としては例えば水素原子、メチル基、エチル基、ブチル基、プロピル基、エチニル基、シクロヘキシル基、それぞれ水酸基で置換されたフェニル基、ナフチル基等が挙げられる。

【0062】ここで、溶解制御剤の酸不安定基としては、下記一般式(L1)~(L5)で示される基、炭素数4~20の非環状の三級アルキル基、各アルキル基の炭素数がそれぞれ1~6のトリアルキルシリル基、炭素数4~20のオキソアルキル基等が挙げられる。

[0063] [化20]

(L5)

ここで、 $R^{L\,01}\sim R^{L\,16}$ 、a、m、n の定義及び具体例は 30 上記と同様である。

【0064】上記溶解制御剤の配合量は、ベース樹脂100部に対し、0~50部、好ましくは5~50部、より好ましくは10~30部であり、単独又は2種以上を混合して使用できる。配合量が5部に満たないと解像性の向上がない場合があり、50部を超えるとパターンの膜減りが生じ、解像度が低下する場合がある。

【0065】なお、上記のような溶解制御剤は、フェノール性水酸基又はカルボキシ基を有する化合物に対し、 有機化学的処方を用いて酸不安定基を導入することにより合成される。

【0066】更に、本発明のレジスト材料には、塩基性化合物を配合することができる。塩基性化合物としては、酸発生剤より発生する酸がレジスト膜中に拡散する際の拡散速度を抑制することができる化合物が適している。塩基性化合物の配合により、レジスト膜中での酸の拡散速度が抑制されて解像度が向上し、露光後の感度変化を抑制したり、基板や環境依存性を少なくし、露光余裕度やバターンプロファイル等を向上することができる。

【0067】このような塩基性化合物としては、第一級、第二級、第三級の脂肪族アミン類、混成アミン類、 芳香族アミン類、複素環アミン類、カルボキシ基を有する含窒素化合物、スルホニル基を有する含窒素化合物、水酸基を有する含窒素化合物、ヒドロキシフェニル基を有する含窒素化合物、アルコール性含窒素化合物、アミド誘導体、イミド誘導体等が挙げられる。

【0068】具体的には、第一級の脂肪族アミン類として、アンモニア、メチルアミン、エチルアミン、ロープロピルアミン、イソプロピルアミン、ローブチルアミン、イソプチルアミン、secーブチルアミン、tertーブチルアミン、ペンチルアミン、たertーアミルアミン、シクロペンチルアミン、ヘキシルアミン、シクロヘキシルアミン、ヘプチルアミン、オクチルアミン、ノニルアミン、デシルアミン、ドデシルアミン、セチルアミン、メチレンジアミン、ボチレンジアミン、エチレンジアミン、テトラエチレンペンタミン等が例示され、第二級の脂肪族アミン類として、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジーロープロピルアミン、ジイソプロピルアミン、ジーnーブチルアミン、ジイソプチルアミン、ジーsecーブチルアミン、ジペンチルアミン、ジシクロペンチルアミン、

ジヘキシルアミン、ジシクロヘキシルアミン、ジヘプチ ルアミン、ジオクチルアミン、ジノニルアミン、ジデシ ルアミン、ジドデシルアミン、ジセチルアミン、N, N ージメチルメチレンジアミン、N, Nージメチルエチレ ンジアミン、N, N-ジメチルテトラエチレンペンタミ ン等が例示され、第三級の脂肪族アミン類として、トリ メチルアミン、トリエチルアミン、トリーnープロピル アミン、トリイソプロピルアミン、トリーnープチルア ミン、トリイソブチルアミン、トリーsecーブチルア ミン、トリペンチルアミン、トリシクロペンチルアミ ン、トリヘキシルアミン、トリシクロヘキシルアミン、 トリヘプチルアミン、トリオクチルアミン、トリノニル アミン、トリデシルアミン、トリドデシルアミン、トリ セチルアミン、N, N, N', N'ーテトラメチルメチ レンジアミン、N, N, N', N'-テトラメチルエチ レンジアミン、N, N, N', N'-テトラメチルテト ラエチレンペンタミン等が例示される。

【0069】また、混成アミン類としては、例えばジメ チルエチルアミン、メチルエチルプロピルアミン、ベン ジルアミン、フェネチルアミン、ベンジルジメチルアミ 20 ン等が例示される。芳香族アミン類及び複素環アミン類 の具体例としては、アニリン誘導体(例えばアニリン、 N-メチルアニリン、N-エチルアニリン、N-プロピ ルアニリン、N, N-ジメチルアニリン、2-メチルア ニリン、3-メチルアニリン、4-メチルアニリン、エ チルアニリン、プロピルアニリン、トリメチルアニリ ン、2-ニトロアニリン、3-ニトロアニリン、4-ニ トロアニリン、2, 4ージニトロアニリン、2, 6ージ ニトロアニリン、3, 5-ジニトロアニリン、N, N-ジメチルトルイジン等)、ジフェニル (pートリル)ア 30 ミン、メチルジフェニルアミン、トリフェニルアミン、 フェニレンジアミン、ナフチルアミン、ジアミノナフタ レン、ピロール誘導体(例えばピロール、2Hーピロー ル、1ーメチルピロール、2,4-ジメチルピロール、 2, 5-ジメチルピロール、N-メチルピロール等)、 オキサゾール誘導体(例えばオキサゾール、イソオキサ ソール等)、チアゾール誘導体(例えばチアゾール、イ ソチアゾール等)、イミダゾール誘導体(例えばイミダ ソール、4ーメチルイミダゾール、4ーメチルー2ーフ ェニルイミダゾール等)、ピラゾール誘導体、フラザン 40 誘導体、ピロリン誘導体(例えばピロリン、2-メチル -1-ピロリン等)、ピロリジン誘導体(例えばピロリ ジン、Nーメチルピロリジン、ピロリジノン、Nーメチ ルピロリドン等)、イミダゾリン誘導体、イミダゾリジ ン誘導体、ピリジン誘導体(例えばピリジン、メチルピ リジン、エチルピリジン、プロピルピリジン、ブチルピ リジン、4-(1-ブチルペンチル) ピリジン、ジメチ ルピリジン、トリメチルピリジン、トリエチルピリジ ン、フェニルピリジン、3-メチル-2-フェニルピリ ジン、4-tert-プチルピリジン、ジフェニルピリ

ジン、ベンジルピリジン、メトキシピリジン、ブトキシ ピリジン、ジメトキシピリジン、1-メチルー2-ピリ ジン、4-ピロリジノピリジン、1-メチルー4-フェ ニルピリジン、2~(1-エチルプロピル)ピリジン、 アミノピリジン、ジメチルアミノピリジン等)、ピリダ ジン誘導体、ピリミジン誘導体、ピラジン誘導体、ピラ ソリン誘導体、ピラソリジン誘導体、ピペリジン誘導 体、ピペラジン誘導体、モルホリン誘導体、インドール 誘導体、イソインドール誘導体、1H-インダゾール誘 導体、インドリン誘導体、キノリン誘導体(例えばキノ リン、3-キノリンカルボニトリル等)、イソキノリン 誘導体、シンノリン誘導体、キナゾリン誘導体、キノキ サリン誘導体、フタラジン誘導体、プリン誘導体、プテ リジン誘導体、カルバゾール誘導体、フェナントリジン 誘導体、アクリジン誘導体、フェナジン誘導体、1.1 0-フェナントロリン誘導体、アデニン誘導体、アデノ シン誘導体、グアニン誘導体、グアノシン誘導体、ウラ シル誘導体、ウリジン誘導体等が例示される。

【0070】更に、カルボキシ基を有する含窒素化合物 としては、例えばアミノ安息香酸、インドールカルボン 酸、アミノ酸誘導体(例えばニコチン酸、アラニン、ア ルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシン、 ヒスチジン、イソロイシン、グリシルロイシン、ロイシ ン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、リジ ン、3-アミノピラジン-2-カルボン酸、メトキシア ラニン等) 等が例示され、スルホニル基を有する含窒素 化合物として3ーピリジンスルホン酸、pートルエンス ルホン酸ピリジニウム等が例示され、水酸基を有する含 窒素化合物、ヒドロキシフェニル基を有する含窒素化合 物、アルコール性含窒素化合物としては、2-ヒドロキ シピリジン、アミノクレゾール、2,4-キノリンジオ ール、3ーインドールメタノールヒドレート、モノエタ ノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールア ミン、N-エチルジエタノールアミン、N. N-ジエチ ルエタノールアミン、トリイソプロパノールアミン、 2, 2'ーイミノジエタノール、2ーアミノエタノー ル、3-アミノ-1-プロパノール、4-アミノ-1-ブタノール、4-(2-ヒドロキシエチル) モルホリ ン、2-(2-ヒドロキシエチル) ピリジン、1-(2 ーヒドロキシエチル) ピペラジン、1-[2-(2-ヒ ドロキシエトキシ) エチル] ピペラジン、ピペリジンエー タノール、1-(2-ヒドロキシエチル)ピロリジン、 1-(2-ヒドロキシエチル)-2-ピロリジノン、3 ーピペリジノー1、2ープロパンジオール、3ーピロリ ジノー1、2ープロパンジオール、8ーヒドロキシユロ リジン、3-クイヌクリジノール、3-トロパノール、 1-メチルー2-ピロリジンエタノール、1-アジリジ ンエタノール、N- (2-ヒドロキシエチル) フタルイ ミド、N- (2-ヒドロキシエチル) イソニコチンアミ ド等が例示される。アミド誘導体としては、ホルムアミ



ド、Nーメチルホルムアミド、N, Nージメチルホルム アミド、アセトアミド、Nーメチルアセトアミド、N, Nージメチルアセトアミド、プロピオンアミド、ベンズ アミド等が例示される。イミド誘導体としては、フタル イミド、サクシンイミド、マレイミド等が例示される。

(式中、R<sup>301</sup>、R<sup>302</sup>、R<sup>303</sup>、R<sup>307</sup>、R<sup>308</sup> はそれぞ れ独立して炭素数1~20の直鎖状、分岐状又は環状の アルキレンを示す。R<sup>304</sup> 、R<sup>305</sup> 、R<sup>306</sup> 、R<sup>309</sup> 、R 310 はそれぞれ独立して水素原子、炭素数1~20の直 鎖状、分岐状又は環状のアルキル又はアミノを示す。R 304 ER 305 R 304 ER 306 R 305 ER 30 6 R 304 ER 305 とR306 、R309 とR310 はそれぞれ結合して環を形成 してもよく、その場合には、R<sup>304</sup>、R<sup>305</sup>、R<sup>306</sup>、R 309 、R310 は上記条件の基から水素原子1個乃至2個を 30 除いた2価乃至3価の基を示す。S、T、Uはそれぞれ 0~20の整数である。但し、S、T、U=0のとき、 R<sup>304</sup> 、R<sup>305</sup> 、R<sup>306</sup> 、R<sup>309</sup> 、R<sup>310</sup> は水素原子を含ま ない。R311 はそれぞれ独立して炭素数1~5のアルキ レンを示す。R<sup>312</sup> はそれぞれ独立して- (C=O) -、- (C=O) O-又は-O (C=O) O-の部分構 造のいずれか1種以上を含む炭素数1~20の直鎖状、 分岐状又は環状のアルキルを示す。--R313\_は水素原子又 は炭素数1~20の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル を示す。R314 はそれぞれ独立して水素原子、炭素数1 ~20の直鎖状、分岐状又は環状のアルキルを示し、-O-、- (C=O) -、- (C=O) O-又は-O (C =O) O-の部分構造のいずれか1種以上を含んでもよ い。R<sup>312</sup> 同士、R<sup>312</sup> とR<sup>313</sup> 、R<sup>314</sup> 同士、R<sup>313</sup> とR 314 はそれぞれ結合して環を形成してもよく、その場合 には、R<sup>312</sup> 、R<sup>313</sup> 、R<sup>314</sup> は上記条件の基から水素原 子1個乃至2個を除いた2価乃至3価の基を示す。) [0072] CCC、R301、R302、R303、R307、R 308 のアルキレンとしては、炭素数1~20、好ましく は1~10、より好ましくは1~8のものであり、これ 50

更に、下記一般式(B1)~(B6)で示される塩基性 化合物を配合することもできる。

[0071] [化21]

らは直鎖状、分岐状又は環状のいずれであってもよく、 具体的には、メチレン、エチレン、nープロピレン、イ ソプロピレン、nーブチレン、イソブチレン、nーペン チレン、イソペンチレン、ヘキシレン、ノニレン、デシ レン、シクロペンチレン、シクロヘキシレン等が挙げら れる。

【0073】R<sup>304</sup>、R<sup>305</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>309</sup>、R<sup>310</sup>のアルキルとしては、炭素数1~20、好ましくは1~8、より好ましくは1~6のものであり、これらは直鎖状、分岐状又は環状のいずれであってもよく、具体的には、メチル、エチル、nープロビル、イソプロビル、nーブチル、イソプチル、tertーブチル、nーペンチル、イソペンチル、ヘキシル、ノニル、デシル、ドデシル、トリデシル、シクロペンチル、シクロペキシル等が挙げられる。R<sup>304</sup>とR<sup>305</sup>、R<sup>305</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>とR<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>306</sup>、R<sup>3</sup>

[0074] S、T、Uはそれぞれ $0\sim20$ の整数であり、好ましくは $1\sim10$ 、より好ましくは $1\sim8$ の整数である。

【0075】R<sup>311</sup> のアルキレンとしては、炭素数1~5、好ましくは1~4、より好ましくは1~3のものであり、具体的には、メチレン、エチレン、nープロピレン、イソプロピレン、nーブチレン、イソプチレン、nーペンチレン、イソペンチレン等が挙げられる。

【0076】R<sup>312</sup> の基としては、具体的には、フォル

ミル、アセチル、ピパロイル、メトキシカルボニル、エ トキシカルボニル、tertープトキシカルボニル、メ トキシカルボニルメチル、エトキシカルボニルメチル、 tertープトキシカルボニルメチル、2ーオキソオキ ソランー3-イル、2-オキソー5-メチルオキソラン -5-イル、2-オキソー1,3-ジオキソラン-4-イルメチル等が挙げられる。

【0077】R<sup>313</sup> のアルキルとしては、炭素数1~2 0、好ましくは1~8、より好ましくは1~6のもので あり、これらは直鎖状、分岐状又は環状のいずれであっ 10 てもよく、具体的には、R<sup>304</sup> 、R<sup>305</sup> 、R<sup>306</sup> 、R<sup>309</sup> 、 R310 と同様のものが挙げられる。

【0078】R314 のアルキルとしては、炭素数1~2 0、好ましくは1~8、より好ましくは1~6のもので あり、これらは直鎖状、分岐状又は環状のいずれであっ てもよく、具体的には、R<sup>304</sup> 、R<sup>305</sup> 、R<sup>306</sup> 、R<sup>309</sup> 、 R<sup>310</sup> と同様のものが挙げられる。R<sup>314</sup> は-O-、-(C=O) -、- (C=O) O-又は-O (C=O) O - の部分構造のいずれか1種以上を含んでもよく、この 場合のR314 としては、具体的には、メトキシメチル、 1-エトキシエチル、テトラヒドロピラン-2-イル、 フォルミル、アセチル、ピパロイル、メトキシカルボニ ル、エトキシカルボニル、 t e r t ーブトキシカルボニ ル、メトキシカルボニルメチル、エトキシカルボニルメ チル、tertーブトキシカルボニルメチル、2ーオキ ソオキソラン-3-イル、2-オキソ-5-メチルオキ ソラン-5-イル、2-オキソ-1, 3-ジオキソラン - 4-イルメチル等が挙げられる。

【0079】R<sup>312</sup> 同士、R<sup>312</sup> とR<sup>313</sup> 、R<sup>314</sup> 同士、R 313 と R 314 が環を形成する場合、その環の炭素数は 1~ 30 20、好ましくは1~8、より好ましくは1~6であ り、これらの環には炭素数1~6、好ましくは1~4の アルキルが懸垂していてもよい。

【0080】上記式 (B1) ~ (B6) の化合物として 具体的には、トリス (2-メトキシメトキシエチル) ア ミン、トリス {2-(2-メトキシエトキシ) エチル} アミン、トリス {2-(2-メトキシエトキシメトキ シ) エチル) アミン、トリス (2-(1-メトキシエト キシ) エチル} アミン、トリス {2-(1-エトキシエ トキシ) エチル} アミン、トリス {2-(1-エトキシ 40 プロポキシ) エチル} アミン、トリス [2-{2-(2 ーヒドロキシエトキシ) エトキシ} エチル] アミン、 4, 7, 13, 16, 21, 24-ヘキサオキサー1,

10-ジアザビシクロ[8.8.8] ヘキサコサン、 4, 7, 13, 18-テトラオキサー1, 10-ジアザ ビシクロ [8. 5. 5] エイコサン、1, 4, 10, 1 3ーテトラオキサー7, 16ージアザビシクロオクタデ カン、1-アザー12-クラウン-4、1-アザー15 ークラウンー5、1ーアザー18ークラウンー6、トリ ス (2-フォルミルオキシエチル) アミン、トリス (2 ーアセトキシエチル) アミン、トリス (2-エチルカル ボニルエチル) アミン、トリス (2-ピパロイルオキシ エチル) アミン、トリス (2-メトキシカルボニルオキ シエチル) アミン、トリス (2-エトキシカルボニルオ キシエチル) アミン、トリス (tertープトキシカル ボニルオキシエチル) アミン、トリス (2-メトキシカ ルボニルメトキシエチル) アミン、トリス (2-シクロ ヘキシルオキシカルボニルメトキシエチル) アミン、ト リス (2-メトキシメトキシカルボニルメトキシエチ ル) アミン、トリス {2-(1-エトキシエトキシカル ボニルメトキシ) エチル} アミン等が挙げられる。

【0081】上記塩基性化合物の配合量は、酸発生剤1 部に対して0.001~10部、好ましくは0.01~ 1部である。配合量が0.001部未満であると添加剤 としての効果が十分に得られない場合があり、10部を 超えると解像度や感度が低下する場合がある。

【0082】更に、本発明のレジスト材料には、分子内 に≡C−C○○Hで示される基を有する化合物を配合す ることができる。

【0083】分子内に≡C-COOHで示される基を有 する化合物としては、例えば下記Ⅰ群及びⅠⅠ群から選 ばれる1種又は2種以上の化合物を使用することができ るが、これらに限定されるものではない。本成分の配合 により、レジストのPED安定性が向上し、窒化膜基板 上でのエッジラフネスが改善されるのである。

[I群] 下記一般式 (A1) ~ (A10) で示される化 合物のフェノール性水酸基の水素原子の一部又は全部を - R<sup>401</sup> - COOH (R<sup>401</sup> は炭素数1~10の直鎖状又) は分岐状のアルキレン基)により置換してなり、かつ分 子中のフェノール性水酸基(C)と≡C-COOHで示 される基(D) とのモル比率がC/(C+D) = 0.1 ~1.0である化合物。

[II群] 下記一般式 (A11)~ (A15) で示され る化合物。

[0084]

【化22】

(3)

(但し、式中R<sup>408</sup> は水素原子又はメチル基を示す。R<sup>402</sup>、R<sup>403</sup>はそれぞれ水素原子又は炭素数1~8の直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルケニル基を示す。R<sup>404</sup> は水素原子又は炭素数1~8の直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルケニル基、あるいはー(R<sup>409</sup>)<sub>b</sub>ーCOO<sup>--</sup>H)を示す。R<sup>405</sup>は一(CH<sub>2</sub>)<sub>1</sub>ー(i=2~1 0)、炭素数6~10のアリーレン基、カルボニル基、スルホニル基、酸素原子又は硫黄原子を示す。R<sup>406</sup>は炭素数1~10のアリーレン基、カルボニル基、成素数6~10のアリーレン基、カルボニル基、で素数6~10のアリーレン基、カルボニル基、スルホニル基、酸素原子又は硫黄原子を示す。R<sup>406</sup>は炭素数1~10のアルキレン基、スルホニル基、酸素原子又は硫黄原子を示す。R<sup>407</sup>は水素原子又は炭素数1~8の直鎖状又は分岐状のアルキル基、アルケニル基、それぞれ水酸基で置換されたフェニル基又はナフチル基を示

す。R40 は炭素数1~10の直鎖状又は分岐状のアル

(OH)<sub>0</sub> R<sup>403</sup> (OH)<sub>12</sub> R<sup>403</sup> (OH)<sub>12</sub>

キレン基を示す。R<sup>410</sup> は水素原子又は炭素数1~8の 直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルケニル基又は一 R<sup>411</sup> -COOH基を示す。R<sup>411</sup> は炭素数1~10の直 鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。jは0~5の整 数である。u、hは0又は1である。s1、t1、s 2、t2、s3、t3、s4、t4はそれぞれs1+t 1=8、s-2+t2=5、s3+t3=4、s4+t4 =6を満足し、かつ各フェニル骨格中に少なくとも1つ の水酸基を有するような数である。κは式(A6)の化 合物を重量平均分子量1,000~5,000とする数 である。1は式(A7)の化合物を重量平均分子量1, 000~10,000とする数である。)

[0085] [化23]

(R<sup>402</sup> 、R<sup>403</sup> 、R<sup>411</sup> は上記と同様の意味を示す。R <sup>412</sup> は水素原子又は水酸基を示す。s5、t5は、s5 ≧0、t5≧0で、s5+t5=5を満足する数であ る。h'は0又は1である。) 【0086】本成分として、具体的には下記一般式AI -1~14及びAII-1~10で示される化合物を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。

[0087]。 【化24】

30

(R') は水素原子又は $CH_2COOH$ 基を示し、各化合物においてR' の $10\sim100$ モル%は $CH_2COOH$ 基である。  $\alpha$ 、 $\kappa$ は上記と同様の意味を示す。)

[0088] [化25]

【0089】なお、上記分子内に≡C-COOHで示される基を有する化合物は、1種を単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができる。

【0090】上記分子内に≡C-COOHで示される基を有する化合物の添加量は、ベース樹脂100部に対して0~5部、好ましくは0.1~5部、より好ましくは0.1~2部である。5部より多いとレジスト材料の解像性が低下する場合がある。

(式中、 $R^{501}$ 、 $R^{502}$ 、 $R^{503}$ 、 $R^{504}$ 、 $R^{505}$  はそれぞれ水素原子、又は炭素数  $1\sim 8$  の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基であり、X、Yは0 又は正数を示し、下記値を満足する。 $0\leq X\leq 3$ 0、 $0\leq Y\leq 3$ 0、 $0\leq X$ 

【0094】アセチレンアルコール誘導体として好ましくは、サーフィノール61、サーフィノール82、サーフィノール104E、サーフィノール104H、サーフィノール104A、サーフィノールTG、サーフィノールPC、サーフィノール44

50

【0091】更に、本発明のレジスト材料には、添加剤としてアセチレンアルコール誘導体を配合することができ、これによりレジスト溶液中におけるマイクロバブルの発生を抑制させることができる。

【0092】アセチレンアルコール誘導体としては、下記一般式(S1)、(S2)で示されるものを好適に使用することができる。

[0093]

0、サーフィノール465、サーフィノール485 (Air Products and Chemicals Inc. 製)、サーフィノールE1004 (日信化学工業(株)製)等が挙げられる。

【0.095】上記アセチレンアルコール誘導体の添加量は、レジスト材料100重量%中0.01~2重量%、より好ましくは0.02~1重量%である。0.01重量%より少ないと塗布性及びマイクロバブル抑制効果が十分に得られない場合があり、2重量%より多いとレジスト材料の解像性が低下する場合がある。

【0096】また、本発明のレジスト材料をネガ型とし

て用いる場合に配合される架橋剤としては、下記のよう

物が挙げられる。 [0097] 【化27】

【0098】架橋剤の配合量は、ベース樹脂100部に 対して、好ましくは5~95部、特に好ましくは15~ 85部、更に好ましくは20~75部である。5部未満 では、十分な架橋反応を起こすことが困難で残膜率の低 下、パターンの蛇行、膨潤などを招きやすい。また、9 5部を超えるとスカムが多く現像性が悪化する傾向にあ

【0099】本発明のレジスト材料には、上記成分以外 に任意成分として塗布性を向上させるために慣用されて いる界面活性剤を添加することができる。なお、任意成 30 分の添加量は、本発明の効果を妨げない範囲で通常量と することができる。

【0100】ここで、界面活性剤としては非イオン性の ものが好ましく、パーフルオロアルキルポリオキシエチ レンエタノール、フッ素化アルキルエステル、パーフル オロアルキルアミンオキサイド、パーフルオロアルキル EO付加物、含フッ素オルガノシロキサン系化合物等が 挙げられる。例えばフロラード「FC-430」、「F C-431」(いずれも住友スリーエム(株)製)、サ ーフロン「S-141」、「S-145」(いずれも旭 硝子 (株) 製)、ユニダイン「DS-401」、「DS -403」、「DS-451」 (いずれもダイキン工業 (株) 製)、メガファック「F-8151」(大日本イ ンキ工業 (株) 製) 、「X-70-092」、「X-7 0-093」(いずれも信越化学工業(株)製)等を挙 げることができる。好ましくは、フロラード「FC-4 30」(住友スリーエム(株)製)、「X-70-09 3」(信越化学工業(株)製)が挙げられる。

【0101】本発明のレジスト材料を使用してパターン を形成するには、公知のリソグラフィー技術を採用して 50 行うことができ、例えばシリコンウエハー等の基板上に スピンコーティング等の手法で膜厚が 0.3~2.0μ mとなるように塗布し、これをホットプレート上で60 ~150℃、1~10分間、好ましくは80~130 ℃、1~5分間プリベークする。次いで目的のパターン を形成するためのマスクを上記のレジスト膜上にかざ し、ArFエキシマレーザーを露光量1~100mJ/ c m<sup>2</sup>程度、好ましくは5~50mJ/c m<sup>2</sup>程度となる ように照射した後、ホットプレート上で60~150 ℃、1~5分間、好ましくは80~130℃、1~3分 間ポストエクスポージャベーク(PEB)する。更に、 0.1~5%、好ましくは2~3%のテトラメチルアン モニウムヒドロキシド (TMAH) 等のアルカリ水溶液 の現像液を用い、0.1~3分間、好ましくは0.5~ 2分間、浸漬 (dip) 法、パドル (puddle) 法、スプレー (spray) 法等の常法により現像する ことにより基板上に目的のパターンが形成される。な お、上記範囲を上限及び下限から外れる場合は、目的の パターンを得ることができない場合がある。

#### [0102]

【発明の効果】本発明のレジスト材料は、ArFエキシ マレーザー光に感応し、感度、解像性に優れ、また厚膜 化が可能なためエッチングにも有利であるために、微細 でしかも基板に対して垂直なパターンを容易に形成する ことができるという特徴を有する。

【実施例】以下、実施例及び比較例を示して本発明を具 体的に説明するが、本発明は下記実施例に制限されるも のではない。

[合成例]



#### 酸発生剤の合成

[合成例1] ビス (4-トリフルオロメチルフェニルス ルホニル) ジアソメタン; PAG5) 500mlの4つロフラスコにマグネシウム(3.2) g) テトラヒドロフラン(80ml)を仕込み、撹拌下 4-プロモベンソトリフルオリド(22.5g)を40 ~50℃で約1時間かけて滴下し、30分熟成した後、 20℃以下で硫黄 (3.9g) を加え、更に室温で1時 間撹拌した。 反応混合物を 1 規定塩酸と氷の混合物に注 ぎ、水層をトルエンで抽出し、トルエン層を濃縮し赤褐 10 色液体(26.0g)を得た。500mlの4つロフラ スコに水酸化ナトリウム (4.0g) とエタノール (4 0 g) を仕込んで均一溶液とした後、上記の赤褐色液体 (25.0g) を加え、60℃で塩化メチレン (5.4 g)を約1時間かけて滴下し、更に70℃で4時間撹拌 した。放冷後、水(50g)を加え、水層を塩化メチレ ンで抽出し、塩化メチレン層を濃縮して淡黄色液体(1 8.2g)を得た。500mlの4つロフラスコにこの 淡黄色液体 (17.2g)、タングステン酸ナトリウム (1.0g)、エタノール (90g) を仕込み、50~ 20 H, m) 60℃で28%過酸化水素水(34.0g)を約1時間 かけて滴下し、更に60℃で4時間撹拌した。放冷後、 水 (50g) を加え、吸引濾過により生成した沈殿を吸 引濾過により集め、真空乾燥し白色粉末 (16.0g) を得た。50mlの3つロフラスコにこの白色粉末 (4.3g)、4-アセトアミノベンゼンスルホニルア ジド(3.6g)、塩化メチレン(25g)を仕込み、 氷冷下1,8-ジアザビシクロ-7-ウンデセン(2. 3g)と塩化メチレン(25g)の混合物を約20分か けて滴下した。10分後、反応混合物を半飽和の塩化ア ンモニウム水溶液(100ml)に注ぎ、水層を塩化メ チレンで抽出し、塩化メチレン層を無水硫酸ナトリウム 上で乾燥、濾過し、濃縮後ヘキサンを加え、得られた沈 殿を吸引濾過により集め、真空中で乾燥し、目的のビス (4-トリフルオロメチルフェニルスルホニル) ジアゾ

メタン (1.3g) を得た。そのIRスペクトル及びN MRスペクトルは次の通りであった。

IR (KBr): 2133, 1360, 1356, 13 19, 1192, 1155, 1134, 1061, 71  $4 \text{ cm}^{-1}$ 

<sup>1</sup>H NMR (270MHz, CDCl<sub>3</sub>): 8.17 (4H, d), 7.88(4H, d)

【0104】 [合成例2] (ビス(3ートリフルオロメ チルフェニルスルホニル) ジアゾメタン; PAG6)

4ープロモベンソトリフルオリドの代わりに3ープロモ ベンゾトリフルオリドを用いた以外は合成例1と全く同 様にして、ピス (3-トリフルオロメチルフェニルスル ホニル) ジアゾメタンを得た。 I Rスペクトル及びNM Rスペクトルは次の通りであった。

IR (KBr): 2137, 2127, 1360, 13 ·31, 1329, 1327, 1153, 1128, 58  $8 \text{ cm}^{-1}$ 

<sup>1</sup>H NMR (270MHz, CDCl<sub>3</sub>): 8. 25 (4H, m), 7. 97 (2H, m), 7. 78 (2

【0105】 [実施例、比較例] 下記式で示されるフッ 素化ジアゾメタン化合物(PAG1~7)又はジアゾメ タン化合物(PAG8~11)を酸発生剤として、また 下記式で示されるポリマー (Polymer1~8)を ベース樹脂として使用し、下記式で示される溶解制御剤 (DRR1~4)、塩基性化合物、下記式で示される分 子内に≡C-COOHで示される基を有する化合物(A CC1、2) を表に示す組成でFC-430 (住友スリ ーエム(株)製)0.01重量%を含む溶媒中に溶解し てレジスト材料を調合し、更に各組成物を0. 2μmの テフロン (登録商標) 製フィルターで濾過することによ り、レジスト液をそれぞれ調製した。

[0106] 【化28】

$$F_3C$$
  $CF_3$   $CPAG-5$ )

[0107]

[0108]

المرادات الم

[化30]

(Polymer 1) (a1=0.10, b1=0.20, d1=0.70, Mw=9,200)

(Polymer 2) (a1-0.10, b1-0.20, c1-0.30, d1-0.40, Mw-10.300)

> (Polymer 3) (b1=0.50, d1=0.50, Mw=11,800)

(Polymer 4) (b1-0.40, d1-0.60, Mw-8,800)

(Polymer 5) (d1-0.30, d2-0.35, e-0.35, Mw-10,500)

(Polymer 6) (d2-0.50, e-0.50, Mw-8,300)

(Polymer 7) (s2=0.10, b2=0.30, d1=0.60, Mw=27,600)

(Polymer 8) (b2-0.40, d2-0.60, Mw-18, 300)

(Polymer 9) (b3=0.40, d3=0.60, Mw=29,100)

[0109]

【化31】

(DRR 3)

(DRR 2)

60

[0110]

【0111】 レジスト液をシリコンウエハー上へスピンコーティングし、 $0.4\mu$ mの厚さに塗布した。次いで、このシリコンウエハーをホットプレートを用いて10℃で90秒間ベークした。これをArFエキシマレーザー露光装置(リソテックジャパン製)及びArFエキシマレーザーマイクロステッパー(ニコン社製、NA=0.55)を用いて露光し、110℃で90秒間ベー

ニウムヒドロキシドの水溶液で現像を行った。

【0112】レジストの評価は以下の項目について行った。まず、感度(Eth、mJ/cm²)を求めた。次に、0.2 $\mu$ mのラインアンドスペースを1:1で解像  $^{50}$  する露光量を最適露光量(Eop、mJ/cm²)として、この露光量における分離しているラインアンドスペースの最小線幅( $\mu$ m)を評価レジストの解像度とした。日立製作所製測長SEM(S-9200)を用いて0.20 $\mu$ mL/Sのラインにおけるラインエッジラフネスを測定した。パターンの断面形状は、ウエハーを割断し、走査型電子顕微鏡:日立製作所製S-4200を用いて観察した。なお、感度の評価はArFエキシマレ

ク (PEB) を施し、2.38%のテトラメチルアンモ

ーザー露光装置を用いて全てのレジストについて行い、 20 解像性の評価はArFエキシマレーザーマイクロステッパーを用いて一部のレジストについて行った。

【0113】各レジストの組成及び評価結果を表 $1\sim3$ に示す。なお、表 $1\sim3$ において、溶剤及び塩基性化合物は下記の通りである。

PGMEA: プロピレングリコールメチルエーテルアセテート

CyHO:シクロヘキサノン

PG/EL:PGMEA70%と乳酸エチル30%の混合溶剤

30 TBA:トリプチルアミン

TEA: トリエタノールアミン

TMMEA: トリスメトキシメトキシエチルアミン

TMEMEA: トリスメトキシエトキシメトキシエチル アミン

ノミン

TAEA: トリス2, 2', 2"-(アセトキシ) エチルアミン

[0114]

【表1】

40

実施例	福托	酸発生剤	溶解制御剤	塩基性化合物	冷剤	93.83	解像度	形状
	(暗量量)	(蓮量部)	(重量部)	(重量部)	(重量部)	(mJ/cm²)	(µm)	
1	Polymer 1	PAG 1		TBA	POMEA	4.5	0.15	矩形
	(80)	(1)		(0.10)	(480)			
2	Polymer 1	PAG 2		TBA	PGMEA	5.2	•	-
	(80)	(1)		(0.10)	(480)			
3	Polymer 1	PAG 3		TBA	PGMEA	5.6	0.15	矩形
	(80)	(1)		(0.10)	(480)			
4	Polymer 1	PAG 4		TBA	PGMEA	4.8	-	-
	(80)	(1)		(0,10)	(480)			
5	Polymer 1	PAG 5		TBA	PGMEA	3.5	0.15	矩形
	(80)	(1)		(0.10)	(480)			
6	Polymer 1	PAG 6		TBA	PGMEA	5.0	-	-
	(80)	·(t)		(0.10)	(480)			
7.	Polymer 1	PAG 7	·	TBA	PGMEA	5.2	0.15	矩形
	(80)	(1)		(0.10)	(480)			
8	Polymer 1	PAG 1		TBA	CyHO	4.6	0.15	矩形
	(80)	(1)		(0.10)	(560)			
9	Polymer 2	PAG 5		TBA	CyHO	4.8	-	
	(80)	(1)		(0.10)	(560)			· ·
10	Polymer 3	PAG 5		TBA	СуНО	4.3	0.15	矩形
	(80)	(1)		(0.10)	(560)			
11	Polymer 4	PAG 5		TBA	CyHO	4.8	-	-
	(80)	(1)		(0.10)	(560)			
12	Polymer 5	PAG 5		TBA	СуНО	5.2	0.15	矩形
	(80)	(1)		(0.10)	(560)			
13	Polymer 6	PAG 5		TBA	СуНО	5.5	-	<b>-</b> .
	(80)	(1)		(0.10)	(560)			
14	Polymer 7	PAG 5		TBA	СуНО	4.6	0.15	矩形
	(80)	(1)		(0.10)	(560)			
15	Polymer 8	PAG 5		TBA	СуНО	4.8	-	- 0
	(80)	(1)		(0.10)	(560)			
16	Polymer 9	PAG 5	•	TBA	CyHO	5.5	•	
	(80)	(1)		(0.10)	(560)			
17	Polymer 6	PAG 6		TBA	CyHO	5.5	-	-
	(80)			(0.10)	(560)		016	矩形
18	Polymer 6 (80)	PAG 6 (1)		TEA (0.10)	CyHO (560)	5.8	0.15	RETE
		PAG 6		TMMEA	CyHO	4.8	0.15	矩形
19	Polymer 6 (80)	(1)	j	(0.10)	(560)	1.0	U.13	RID
-	Polymer 6	PAG 6		TMEMEA	CvHO	40	0.15	矩形
20	(80)	(1)		(0,10)	(560)	"	W10	. 1210
	Polymer 6	PAG 5		TAEA	CyHO	4.4	0.14	矩形
21	(80)	(1)	1	(0.10)	(560)	""	W.17	NE IE

[0115]

【表2】

40

实施例	制設	融発生剤	溶解制物剂	塩基性化合物	溶剤	25.81	解像座	形状
	(诺曼雷)	(重量部)	(黄量部)	(金金金)	(暗量量)	(mJ/cm²)	(µm)	
22	Polymer 6	PAQ 5	DRR 1	TEA	PQ/EL	50 .	-	-
	(64)	(1)	(16)	(0,10)	(480)		٠	
23	Polymer 6	PAG 5	DRR 2	TEA	PG/EL	4.8		
	(64)	(1)	(16)	(0.10)	(480)	"		
24	Polymer 6	PAG 5	DRR 3	TEA	PG/EL	4.6	-	
	(64)	(1)	(16)	(0,10)	(480)	"		
25	Polymer 6	PAG 5	DRR 4	TEA	PG/EL	4.8	-	-
	(64)	(t)	(16)	<b>(0.10)</b>	(480)			
26	Polymer 7	PAG 5		TEA	CyHO	4.9	-	
	(80)	(1)		(0.10)	(560)			
27	Polymer 7	PAG 5	DRR 1	TEA	СуНО	4.4		-
	(64)	(1)	(16)	(0.10)	(560)			
28	Polymer 7	PAG 5	DRR 2	TEA	СуНО	3.5	-	-
	(64)	(i)	(16)	(0.10)	(560)			
29	Polymer 7	PAG 5	DRR 3	TEA	CyHO	3.9	-	-
	(64)	(1)	(16)	(0.10)	(560)			
30	Polymer 7	PAG 5	DRR 4	TEA	СуНО	3.8	-	-
	(64)	(1)	(16)	(0.10)	(560)			1
31	Polymer 4	PAG 5		TEA	CyHO .	3.8	-	-
	(80)	(1)		(0.10)	(560)			
32	Polymer 4	PAG 5	ACC 1	TEA	СуНО	3.2	-	- ,
	(80)	(1)	(2)	ന്മാ	(560)			
33	Polymer 4	PAG 5	ACG 2	TEA	СуНО	3.0	-	-
	(80)	(1)	(2)	(0.10)	(560)			·
34	Polymer 8	PAG 5		TEA	PGMEA	5.3	-	- ,
	(80)	(1)		(0.10)	(480)			
35	Polymer 8	PAG 5	ACC 1	TEA	PGMEA	5.0	-	-
	(80)	(1)	(2)	(0.10)	(480)			·
36	Polymer 8	PAG 5	ACC 2	TEA	PGMEA	4.9	-	
	(80)	(1)	(2)	(0.10)	(480)			
37	Polymer 3	PAG 5	ŀ	TEA	PG/EL	4.8	-	-
1	(40)	(1)		(0.10)	(480)	ł		
·	Polymer 5		ĺ					
	(40)							
38	Polymer 3	PAG 6		TEA	PG/EL	4.9	-	-
ļ	(40)	O)		(0.10)	(480)		į	
ŀ	Polymer 5				- 1	ļ		
	(40)							
39	Polymer 5	PAG 5		TEA	СуНО	4.8		-
	(40)	(1)		(0.10)	(560)	Į		
1	Polymer 7	1			[	- 1		
	(40)							
40	Polymer 5	PAG 6		TEA	СуНО	3.2	- 1	-
	(40)	(1)	ļ	(0.10)	(560)		l	
. 1	Polymer 7	_	1				- 1	
	(40)							

[0116]

40 【表3】

比較例	SIAS	<b>商発生剤</b>	容解制御刑	塩基性化合物	海刺	四层 (mJ/cm²)	解像区 (µm)	形状
	(暗量量)	(重量部)	(重量部)	(電量量)				
1	Polymer 1	PAG 8		TBA	POMEA	9.1	0.18	テーパー
	(80)	(1)		(0.10)	(480)			
2	Polymer 1	PAG 9		TBA	PGMEA	9.9	-	-
	(80)	(1)	L	(0.10)	(480)			
3	Polymer 1	PAG 10		TBA	PGMEA	9.0	0.18	テーパー
	(80)	(1)		(0.10)	(480)			
4	Polymer 1	PAG 11		TBA	PGMEA	9.4	-	-
	(80)	(1)		(0.10)	(480)			
5	Polymer 2	PAG 10		TBA	PGMEA	9.1	0.18	テーパー
١	(80)	(1)		(0.10)	(480)			
6	Polymer 3	PAG 10		TBA	PGMEA	9.9	-	-
ı I	(80)	(1)		(0.10)	(480)			
7.	Polymer 4	PAG 10		TBA	PGMEA	9.0	0.18	テーパー
٠. ا	(80)	(1) .		(0.10)	(480)			
8	Polymer 5	PAG 10		• тва	PGMEA	9.4	-	-
١ ١	(80)	(1)		(0.10)	(480)	}		
9	Polymer 6	PAG 10		TBA	POMEA	9.3	-	-
- I	(80)	(i)		(0.10)	(480)	1		
10	Polymer 7	PAG 10		TBA	PGMEA	10.0	-	•
	(80)	(1)		(0.10)	(480)			
11	Polymer 8	PAG 10		TBA	PGMEA	10.3	-	-
	(80)	(1)		(0.10)	(480)		ŀ	·
12	Polymer 9	PAG 10		TBA	PGMEA	9.3	-	-
	(80)	(1)		(0,10)	(480)			i

【0117】表1~3の結果より、本発明のレジスト材料が従来品に比べ高透明、高感度及び高解像性であることが確認された。

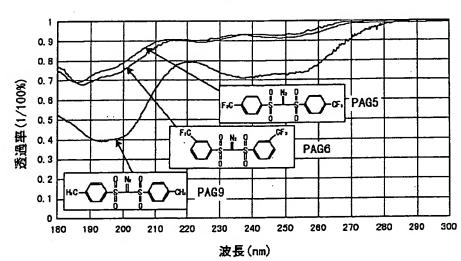
【0118】 [実験例] 上記PAG5、6及び比較としてPAG9を用い、その透過率を評価した。即ち、酸発生剤PAG5、6、比較としてPAG9をそれぞれ2重量部、ポリメチルメタクリレート98重量部をシクロへキサノン600重量部に溶解させた。また、酸発生剤を含まないポリメチルメタクリレートのシクロへキサノン溶液も同様に用意した。それぞれの溶液を0.2μmの

テフロン製フィルターで濾過し、石英基板上にスピンコーティングし、100℃で90秒間ベークして0.5μmの厚さに塗布した。次いで酸発生剤を含まない方の基板をリファレンス側に置き、酸発生剤を含む膜の透過率を測定した。結果を図1に示す。これより、本発明の酸発生剤は250nm以下、特には200nmの波長領域における高透明性が確認された。

# 30 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る酸発生剤と比較酸発生剤の透過率 を示す図である。

【図1】



### フロントページの続き

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C08F	232/00		C 0 8 F 232/00	
C08K	5/00		C08K 5/00	•
C08L	101/00		C 0 8 L 101/00	•
C09K	3/00		C 0 9 K 3/00	K
G03F	7/038	6 0 1	G 0 3 F. 7/038	6 0 1
	7/039	601	7/039	6 0 1
H01L	21/027		C 0 7 C 381/14	
// C07C	381/14		H O 1 L 21/30	502R

(72) 発明者 渡辺 淳

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 

(72)発明者 大澤 洋一

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社合成技術研究所內 Fターム(参考) 2HO25 AAO1 AAO2 AB16 ACO3 ADO1

ADO3 BEO0 BEO7 BE10 BF02

BF11 BG00 CB43 CC03 CC20

FA17

4H006 AA03 AB80 AB81 TA02 TB04

TB74 TC11 TC31

4J002 BG011 BH021 BK001 CE001

EV216 FD206 GP03 HA05

4J100 AK32P AL08P AL08Q AL08R ALO8S ARIIQ ARIIR BAIIP

BA11Q BA16Q BA16R BA20Q

BCO3P BCO3Q BCO3R BCO7Q

BCO7S BC53P BC53Q BC55Q

CAO4 CAO5 CAO6 DAO1 JA38